

# 2026年3月期 第2四半期 決算説明会資料

東証プライム：5991  
日本発条株式会社  
2025年11月28日



# 26.3期 第2四半期連結決算 26.3期 通期業績予想

専務執行役員  
CFO

池尻 修

# 26.3期 第2四半期連結決算

# 26.3期 第2四半期連結決算

**自動車関連** : 国内外において、前年同期比で生産台数が減少

**情報通信関連** : HDDの世界生産台数は前年同期比で減少するも、当社の主力製品であるHDDサスペンションの総需要は増加

(億円)

	25.3期 上期実績	26.3期上期		増減	
		5月時点予想	実績	対前年同期	対5月予想
<b>売上高</b>	<b>3,912</b>	<b>3,910</b>	<b>3,939</b>	<b>27</b>	<b>29</b>
<b>営業利益</b>	<b>229</b>	<b>172</b>	<b>185</b>	<b>△44</b>	<b>13</b>
営業利益率	5.9%	4.4%	4.7%	△1.2%	0.3%
<b>経常利益</b>	<b>269</b>	<b>200</b>	<b>198</b>	<b>△71</b>	<b>△2</b>
経常利益率	6.9%	5.1%	5.0%	△1.9%	△0.1%
<b>親会社株主に帰属する中間純利益</b>	<b>215</b>	<b>150</b>	<b>139</b>	<b>△76</b>	<b>△11</b>
特別損益	20	-	-	△20	-
平均為替レート	U S \$	152.3	145.0	146.6	△5.7 1.6
	タイバーツ	4.2	4.4	4.4	0.2 0.0
期末為替レート	U S \$ (当期)	142.7	145.0	148.9	6.2 3.9
	(前期)	151.4	149.5	149.5	△1.9 -
	タイバーツ (当期)	4.4	4.4	4.4	0.1 0.0
	(前期)	4.1	4.6	4.6	0.5 -

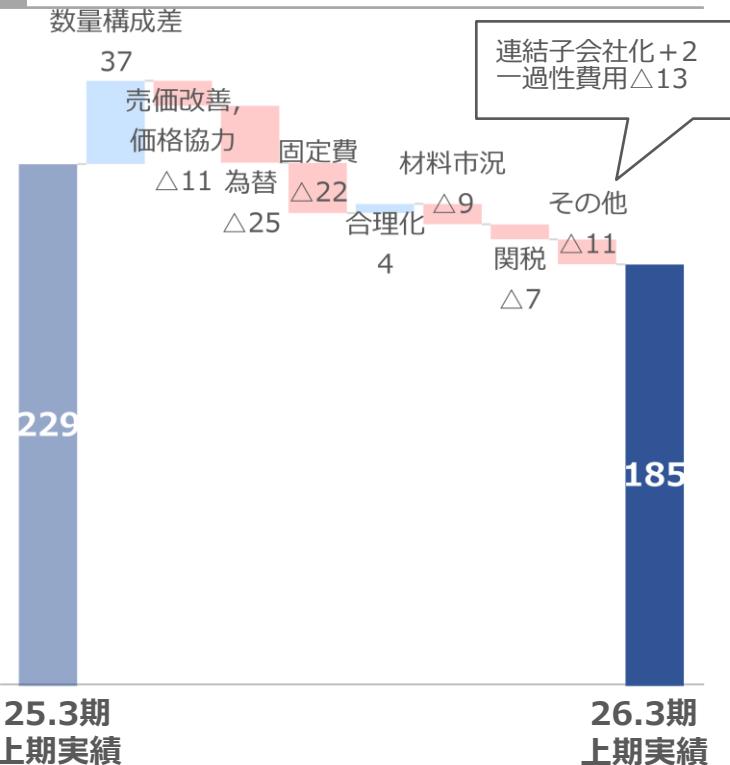
# 営業利益の変動要因分析

(単位：億円)

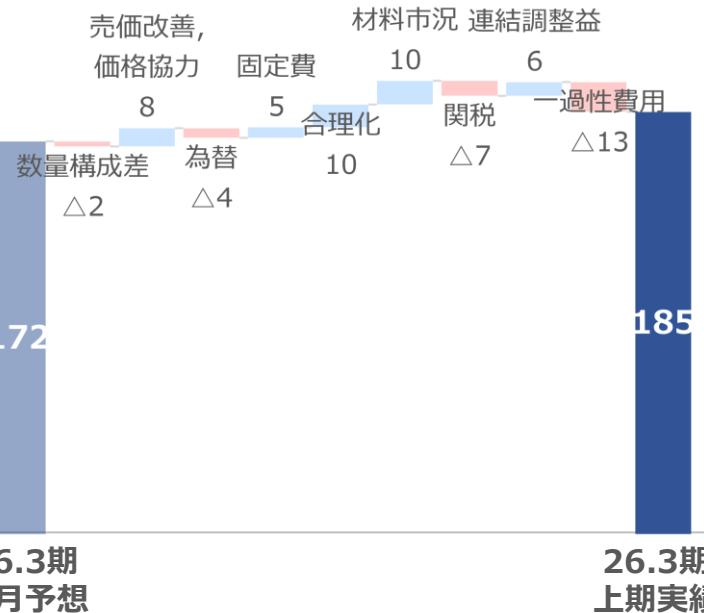
	25.3期 上期実績	26.3期上期		対前年同期 増減	対5月予想 増減
		5月時点予想	実績		
売上高	3,912	3,910	<b>3,939</b>	27	29
営業利益	229	172	<b>185</b>	△44	13
営業利益率	5.9%	4.4%	<b>4.7%</b>	△1.2%	0.3%

## 営業利益の変動要因分析

### (対前年同期増減)



### (対5月予想増減)



### ▽対前年同期実績

HDD関連分野の好調や半導体関連分野の数量増加により増収となったものの、為替による利益押し下げや固定費の増加、米国での一過性の費用もあり、営業利益は対前年同期を下回った。

### ▽対5月時点予想

米国での一過性の費用はあったものの、売価改善や合理化の積み上げ、また棚卸資産に係る連結調整益などもあり、営業利益は増益を確保した。

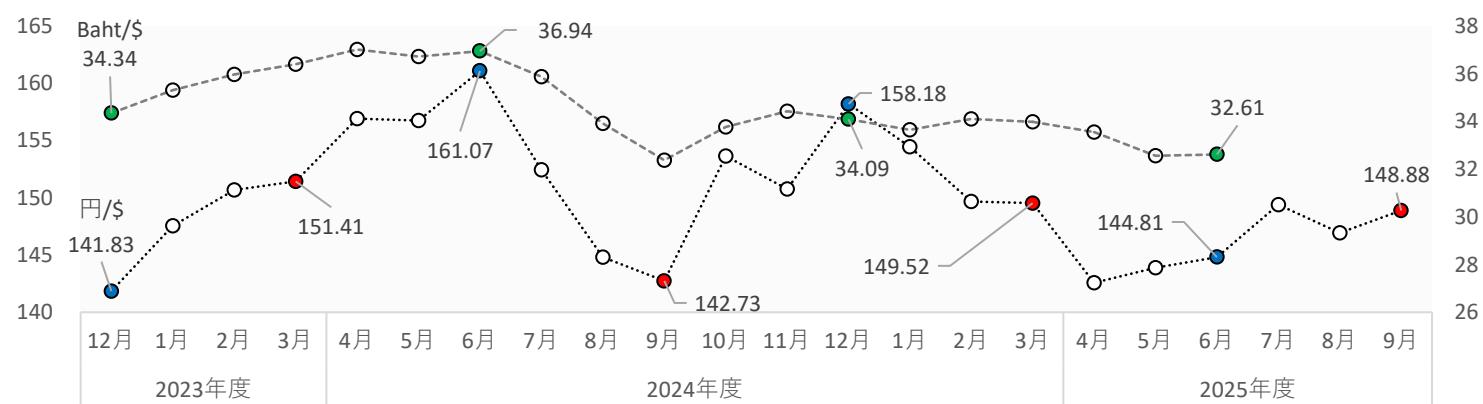
# 営業外損益

(単位：億円)

## 営業外損益 主な内訳

科目	25.3期 上期実績	26.3期上期		対前年同期 増減	対5月予想 増減
		5月時点予想	実績		
営業外損益 為替差損益（日本）	△28	△8	△1	27	7
為替差損益（アジア・米欧ほか）	35	△3	△24	△59	△21
受取配当金	16	16	17	1	1
持分法投資損益	10	6	4	△6	△2
その他	7	16	16	9	0
計	40	27	12	△28	△15

## △ドル円 / ドルBaht為替変動



## △為替差損益

前年同期は、月末にかけて為替レートが急速に円高ドル安へ変動したため、日本国内の事業拠点で為替差損が生じたものの、12月決算会社においては、6月末にかけ主にバーツがドル高へ変動したため、為替差益を計上。

一方、当期は円ドルで期首→期末にかけての変動こそ小さく収まったものの、12月決算会社では6月末にかけ主にバーツがドル安変動となり、為替差損を計上した。

## [為替差損益 拠点別 前年同期差内訳（億円）]

	24-2Q累 (実績)	25-2Q累 (実績)	前年 同期比
ニッパツ	△26	△1	25
タイニッパツ	26	△21	△48
メキシコ	4	△1	△5
その他	2	△1	△3
合計	7	△25	△33

# 事業セグメント別売上高・営業利益の状況

(単位：億円)

	25.3期 上期実績	26.3期上期		対前年同期 増減	対5月予想 増減
		5月時点予想	実績		
■懸架ばね	売上高	835	790	<b>830</b>	△5
	営業利益	△6	△3	<b>3</b>	9
	営業利益率	△0.8%	△0.4%	<b>0.4%</b>	1.1%
■シート	売上高	1,508	1,435	<b>1,420</b>	△88
	営業利益	54	28	<b>20</b>	△34
	営業利益率	3.6%	2.0%	<b>1.4%</b>	△2.2%
■精密部品	売上高	498	510	<b>508</b>	10
	営業利益	17	9	<b>13</b>	△4
	営業利益率	3.4%	1.8%	<b>2.6%</b>	△0.8%
■DDS	売上高	519	585	<b>600</b>	81
	営業利益	126	110	<b>120</b>	△6
	営業利益率	24.3%	18.8%	<b>20.1%</b>	△4.2%
■産業機器ほか	売上高	550	590	<b>580</b>	30
	営業利益	37	28	<b>28</b>	△9
	営業利益率	6.9%	4.7%	<b>4.9%</b>	△2.0%
合計	売上高	3,912	3,910	<b>3,939</b>	27
	営業利益	229	172	<b>185</b>	△44
	営業利益率	5.9%	4.4%	<b>4.7%</b>	△1.2%

## △対前年同期実績

懸架ばね事業は、タイでの一部車種の増加や米欧の赤字幅縮小により黒字に転じたものの、シート事業では、国内やタイでの数量減に加え、米国での構成差や一過性の費用もあり、大幅な減収減益となった。HDD関連事業や半導体プロセス部品は、引き続き増加傾向ではあるが、人件費を含めた将来投資負担の増加やバーツ高による利益の押し下げ等により、減益となった。

## △対5月時点予想

シート事業は、日本国内での台数減や北米において予想以上に一時費用が増加したことで減益となったが、それ以外のセグメントでは、予想並みかそれ以上の営業利益を確保した。

# 地域セグメント別売上高・営業利益の状況

(単位：億円)

	25.3期 上期実績	26.3期上期		対前年同期 増減	対5月予想 増減
		5月時点予想	実績		
●日本	売上高	2,194	2,233	<b>2,194</b>	0 △38
	営業利益	154	91	<b>117</b>	△37 26
	営業利益率	7.0%	4.1%	<b>5.3%</b>	△1.7% 1.3%
●アジア	売上高	1,014	1,049	<b>1,076</b>	61 27
	営業利益	113	98	<b>108</b>	△5 10
	営業利益率	11.2%	9.3%	<b>10.1%</b>	△1.2% 0.7%
●米欧ほか	売上高	702	628	<b>668</b>	△34 40
	営業利益	△38	△17	<b>△40</b>	△1 △23
	営業利益率	△5.5%	△2.7%	<b>△6.0%</b>	△0.5% △3.3%
合計	売上高	3,912	3,910	<b>3,939</b>	27 29
	営業利益	229	172	<b>185</b>	△44 13
	営業利益率	5.9%	4.4%	<b>4.7%</b>	△1.2% 0.3%

## ▽対前年同期実績

## ●日本

DDSで数量増も自動車関連事業の台数減や固定費等増加により、前年同期に対し大幅な減益となった。

## ●アジア

HDD用サスペンションの数量増となったが、売価の下げ影響やバーツ高による利益の押し下げ、またタイでの自動車市場低迷による台数減少があり、前年同期比で利益を下回った。

## ●米欧ほか

懸架ばね事業の赤字幅は縮小したものの、シート事業の利益が落ち込んだ結果、営業利益の改善には至らなかった。

## ▽対5月時点予想

## ●日本

一部を除く自動車関連各社において台数減少となつたが、諸費用上昇分の回収や棚卸資産に係る連結調整益等により増益となった。

## ●アジア

タイの自動車市場の需要が引き続き低迷しているものの、HDD関連部品の売価の下げ影響の抑制等により、増益を確保した。

## ●米欧ほか

数量は増加したが、シート事業の一過性費用や関税負担等により、赤字幅が拡大した。

# 事業セグメント分析：懸架ばね

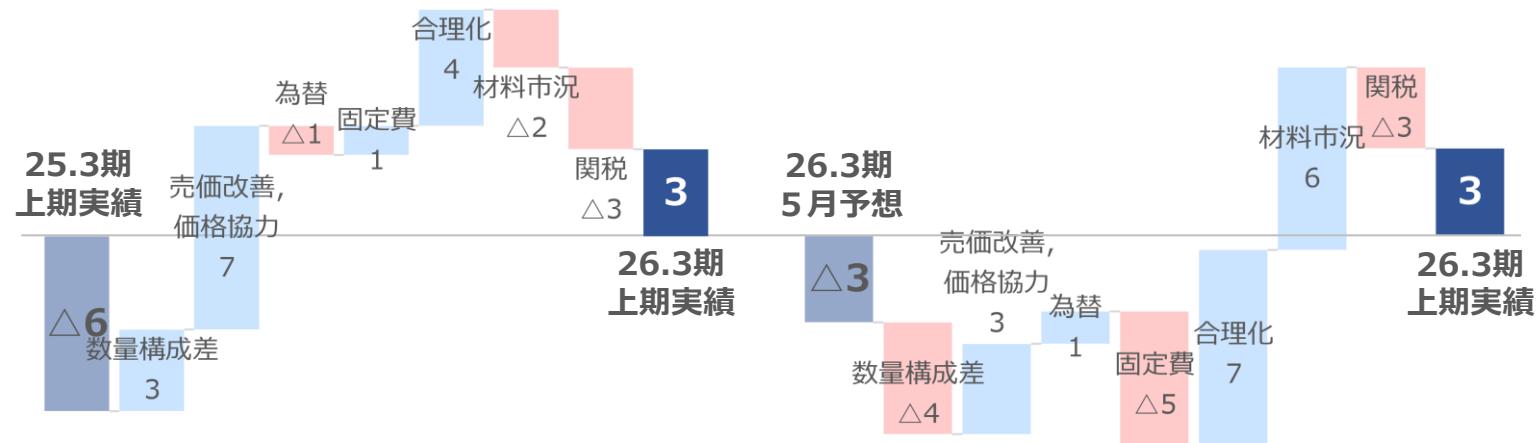
(単位：億円)

	25.3期 上期実績	26.3期上期		対前年同期 増減	対5月予想 増減
		5月時点予想	実績		
売上高	835	790	830	△5	40
営業利益	△6	△3	3	9	6
営業利益率	△0.8%	△0.4%	0.4%	1.1%	0.7%

## 営業利益の変動要因分析

(対前年同期増減)

(対5月予想増減)



## △対前年同期実績

輸出の減少等により日本国内で減益となつたものの、タイで自動車市場が低迷するなか一部車種の数量増等により増益となつたほか、売価改善や合理化の積み上げ等もあり、増益となつた。

## △対5月時点予想

米欧地域においては数量の増加に伴う固定費増や関税影響により減益となつたものの、タイでは計画に対する数量減を売価改善や合理化の積み上げ等により挽回し、営業利益は改善した。

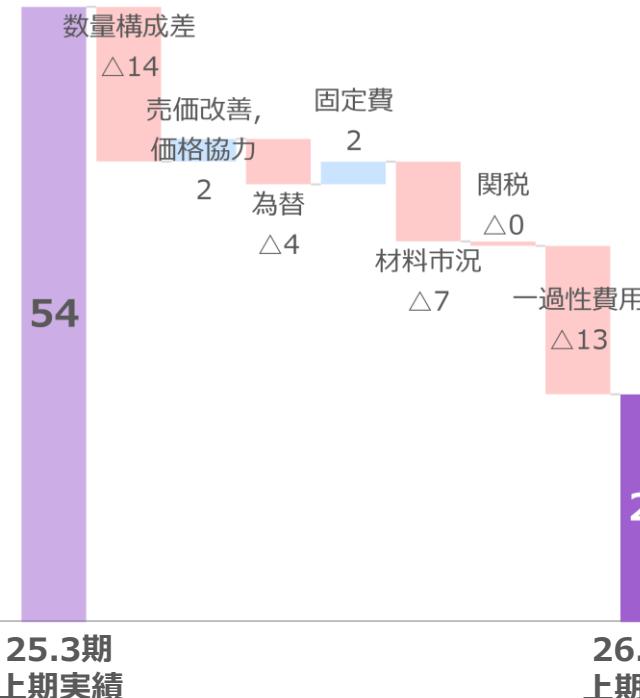
# 事業セグメント分析：シート

(単位：億円)

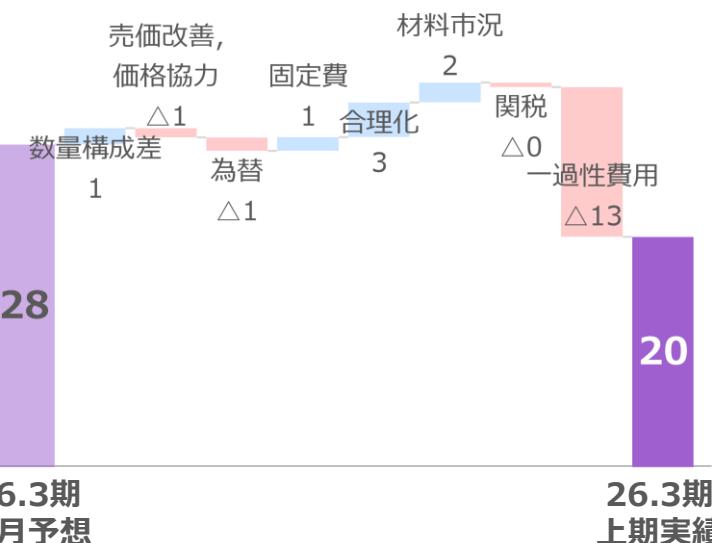
	25.3期 上期実績	26.3期上期		対前年同期 増減	対5月予想 増減
		5月時点予想	実績		
売上高	1,508	1,435	1,420	△88	△15
営業利益	54	28	20	△34	△8
営業利益率	3.6%	2.0%	1.4%	△2.2%	△0.6%

## 営業利益の変動要因分析

### (対前年同期増減)



### (対5月予想増減)



### ▽対前年同期実績

国内外において軒並み台数が減少し、加えて北米では車種・品種構成が悪化。また一過性の費用も大きく影響し、減収減益となつた。

### ▽対5月時点予想

一部を除く国内カーメーカーでは台数減少となり、固定費等の圧縮に努めるも、北米での一過性の費用等もあり、減収減益の結果となつた。

# 事業セグメント分析：精密部品

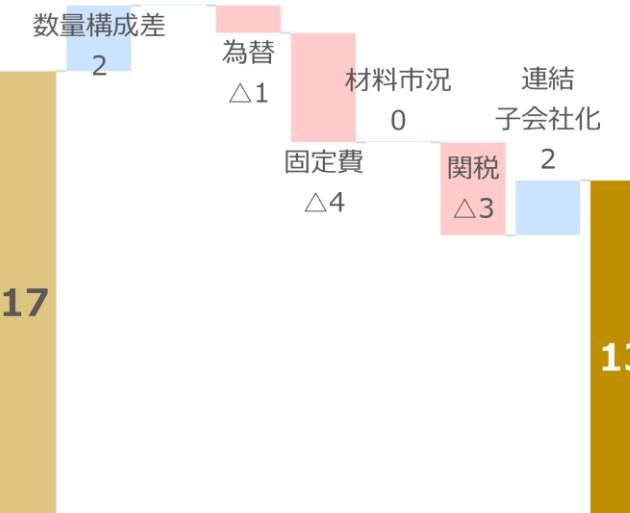
(単位：億円)

	25.3期 上期実績	26.3期上期		対前年同期 増減	対5月予想 増減
		5月時点予想	実績		
売上高	498	510	508	10	△2
営業利益	17	9	13	△4	4
営業利益率	3.4%	1.8%	2.6%	△0.8%	0.8%

## 営業利益の変動要因分析

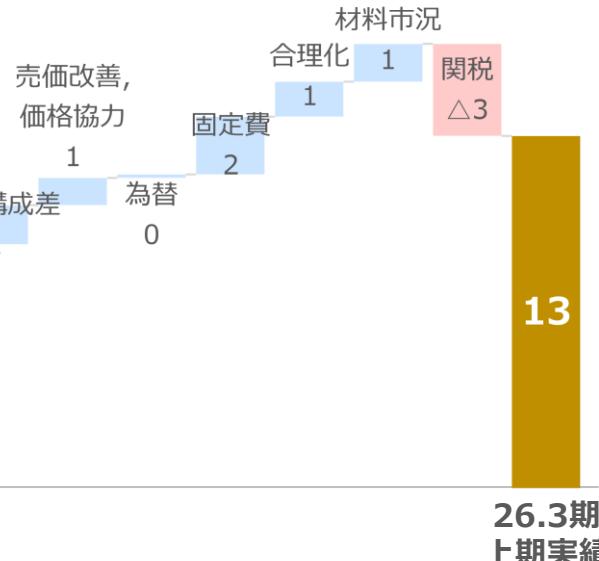
### (対前年同期増減)

売価改善、  
価格協力  
0



### (対5月予想増減)

売価改善、  
価格協力  
1  
数量構成差  
1  
為替  
0



### △対前年同期実績

HDD用機構部品の数量増加やインド子会社の連結子会社化により増収となったものの、人件費も含めた将来投資負担の増加等により、前年同期を下回る利益水準となった。

### △対5月時点予想

国内においては予想を下回る利益となつたが、タイでの数量増による増益があり、減収ながら増益となつた。

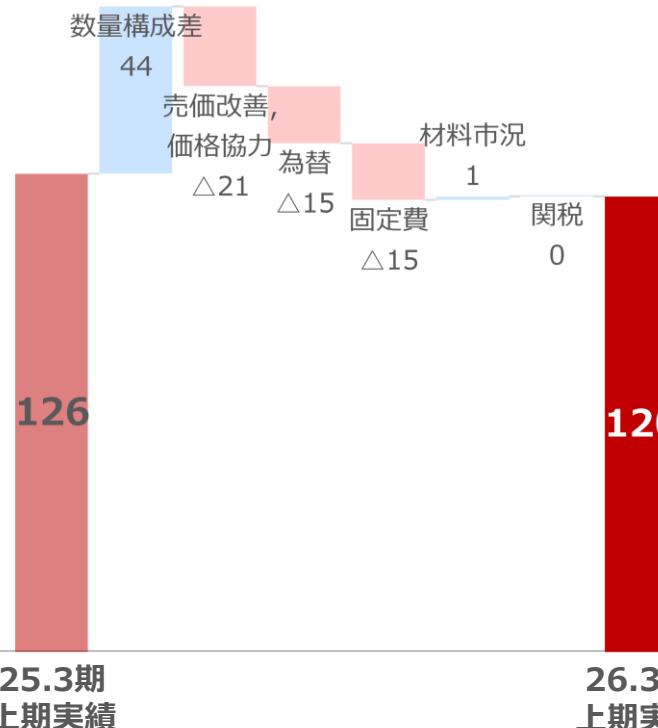
# 事業セグメント分析：DDS

(単位：億円)

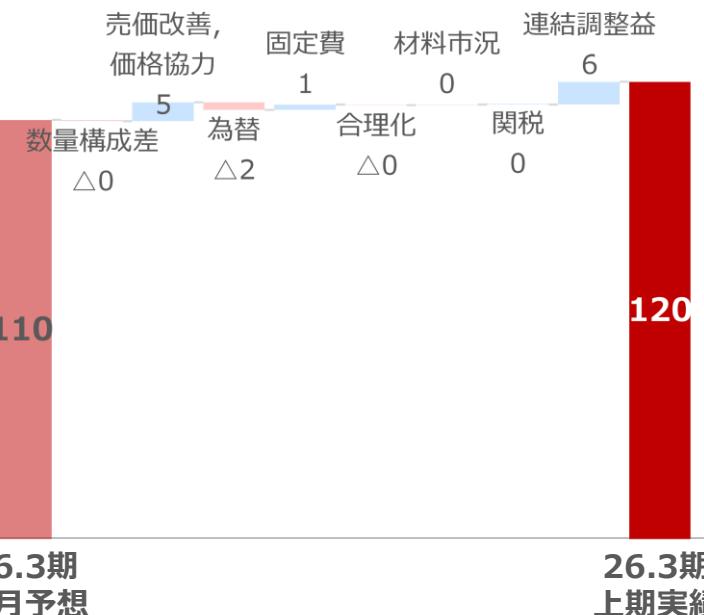
	25.3期 上期実績	26.3期上期		対前年同期 増減	対5月予想 増減
		5月時点予想	実績		
売上高	519	585	600	81	15
営業利益	126	110	120	△6	10
営業利益率	24.3%	18.8%	20.1%	△4.2%	1.3%

## 営業利益の変動要因分析

### (対前年同期増減)



### (対5月予想増減)



### ▽対前年同期実績

データセンター向け高容量HDDの需要は継続し、HDD用サスペンションの売上数量は前年同期比で増加となったが、売価の下げ影響や為替による利益の押し下げ、また人件費を含めた将来投資負担の増加により、增收減益となった。

### ▽対5月時点予想

HDD用サスペンションの売上数量は若干下振れしたものの、売価下落の抑制や棚卸資産に係る連結調整益などにより增收増益を確保した。

# 事業セグメント分析：産業機器ほか

(単位：億円)

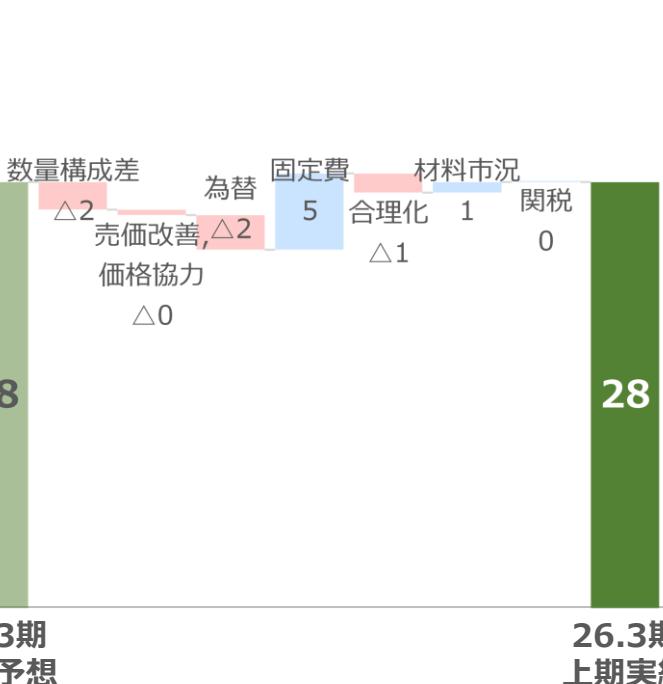
	25.3期 上期実績	26.3期上期		対前年同期 増減	対5月予想 増減
		5月時点予想	実績		
売上高	550	590	580	30	△10
営業利益	37	28	28	△9	0
営業利益率	6.9%	4.7%	4.9%	△2.0%	0.1%

## 営業利益の変動要因分析

### (対前年同期増減)

 売価改善、  
 価格協力


### (対5月予想増減)

 数量構成差  
 △2  
 為替  
 △2  
 固定費  
 5  
 材料市況  
 1  
 関税  
 △1


### ▽対前年同期実績

半導体プロセス部品の数量は前年比で増加したものの、金属基板事業は需要が伸び悩み数量減。また化成品事業撤退や円高による利益の押し下げ、また人件費を含めた将来投資負担の増加等により、全体では、增收減益となった。

### ▽対5月時点予想

半導体プロセス部品や金属基板の数量が計画より減少し、レジャー分野の低迷による減収もあったものの、固定費の削減等により、概ね予想通りの着地となつた。

# 26.3期 通期業績予想

# 26.3期 通期業績予想

(億円)

	25.3期 実績	26.3期		増減	
		5月時点予想	今回予想	対前期	対5月予想
売上高	8,016	8,000	8,000	△16	-
営業利益	521	470	470	△51	-
営業利益率	6.5%	5.9%	5.9%	△0.6%	-
経常利益	579	530	530	△49	-
経常利益率	7.2%	6.6%	6.6%	△0.6%	-
親会社株主に帰属する当期純利益	481	400	400	△81	-
特別損益	16	-	-	△16	-
平均為替レート	U S \$	152.5	145.0	148.2	△4.3 3.2
	タイバーツ	4.3	4.4	4.5	0.2 0.1
期末為替レート	U S \$ (当期)	149.5	145.0	150.0	0.5 5.0
	(前期)	151.4	149.5	149.5	△1.9 -
	タイバーツ (当期)	4.6	4.4	4.4	△0.2 -
	(前期)	4.1	4.6	4.6	0.5 -

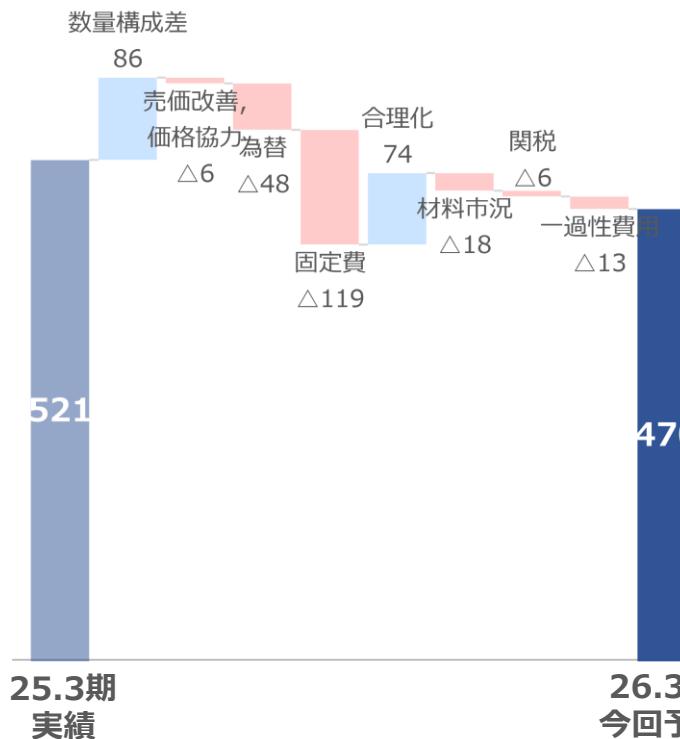
# 営業利益の変動要因分析

(単位：億円)

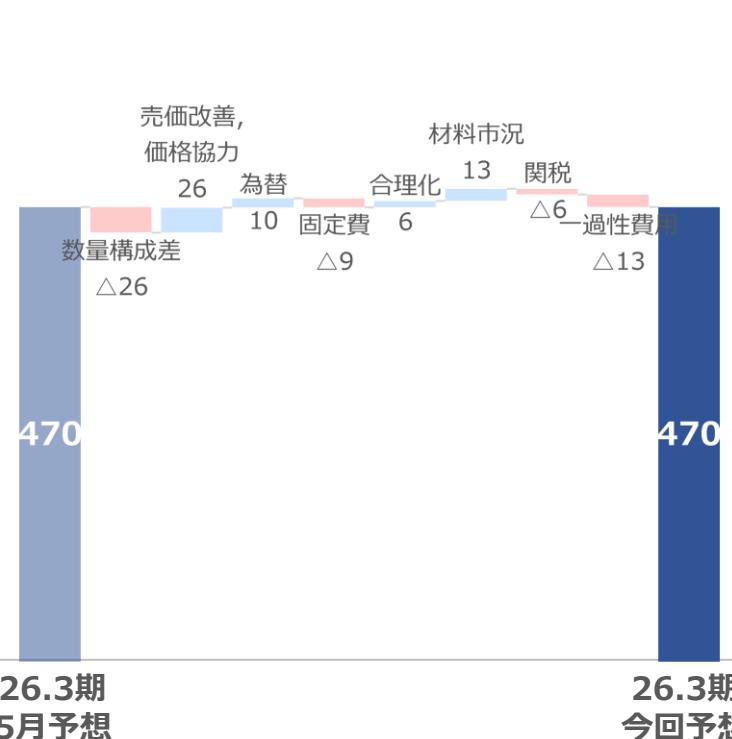
	25.3期 実績	26.3期 5月時点予想	26.3期 実績	対前期 増減	対5月予想 増減
売上高	8,016	8,000	<b>8,000</b>	△16	-
営業利益	521	470	<b>470</b>	△51	-
営業利益率	6.5%	5.9%	<b>5.9%</b>	△0.6%	-

## 営業利益の変動要因分析

### (対前期増減)



### (対5月予想増減)



### ▽対前期実績

HDD関連部品や半導体プロセス部品は数量増はあるものの、シート事業の落ち込み、為替による利益の押し下げ、人件費を含めた将来投資による固定費増の影響により減収減益となる見込み。

また当期は米国の追加関税政策により57億円程度の費用増が見込まれるもの現時点で約9割の回収を織り込み。

### ▽対5月時点予想

HDD関連事業は引き続き好調が見込まれる一方、自動車関連の数量減、半導体プロセス部品の需要の鈍化や金属基板事業の売上拡大遅れが予想される。

しかしながら、価格下落や材料市況影響の抑制等により、全体では期初予想並みの業績で着地する見込み。

# 事業セグメント別売上高・営業利益の予想

(単位：億円)

	25.3期 実績	26.3期通期		対前期 増減	対5月予想 増減
		5月時点予想	今回予想		
■懸架ばね	売上高	1,691	1,575	1,634	△57 59
	営業利益	4	18	21	16 2
	営業利益率	0.3%	1.1%	1.3%	1.0% 0.1%
■シート	売上高	3,039	2,935	2,884	△155 △51
	営業利益	112	95	75	△37 △20
	営業利益率	3.7%	3.2%	2.6%	△1.1% △0.6%
■精密部品	売上高	1,019	1,040	1,043	23 2
	営業利益	42	37	42	0 5
	営業利益率	4.2%	3.6%	4.0%	△0.2% 0.5%
■DDS	売上高	1,115	1,200	1,233	117 33
	営業利益	266	230	253	△13 23
	営業利益率	23.9%	19.2%	20.5%	△3.4% 1.4%
■産業機器ほか	売上高	1,151	1,250	1,206	54 △44
	営業利益	95	90	79	△16 △11
	営業利益率	8.3%	7.2%	6.6%	△1.7% △0.6%
合計	売上高	8,016	8,000	8,000	△16 -
	営業利益	521	470	470	△51 -
	営業利益率	6.5%	5.9%	5.9%	△0.6% -

## ▽対前期実績

HDD関連部品や半導体プロセス部品の数量増はあるものの、為替による利益の押し下げ、人件費を含めた将来投資による固定費増の影響を受け、営業利益は前年水準を下回る見通し。

自動車関連事業は、懸架ばねの回復はあるものの、シートの台数減や米国拠点の一過性費用等の影響で減益の見込み。

## ▽対5月時点予想

シート事業の落ち込みと、産機ほか事業における半導体プロセス部品および金属基板の需要鈍化影響は大きいものの、HDD関連事業は好調に推移し期首予想を上回る見込みで、全体の業績は期初予想並みに着地する見通し。

# 地域セグメント別売上高・営業利益の予想

(単位：億円)

	25.3期 実績	26.3期通期		対前期 増減	対5月予想 増減
		5月時点予想	今回予想		
●日本	売上高	4,574	4,680	<b>4,580</b>	5 △100
	営業利益	399	290	<b>300</b>	△99 10
	営業利益率	8.7%	6.2%	<b>6.6%</b>	△2.2% 0.4%
●アジア	売上高	2,053	2,110	<b>2,105</b>	51 △5
	営業利益	194	207	<b>213</b>	18 6
	営業利益率	9.5%	9.8%	<b>10.1%</b>	0.6% 0.3%
●米欧ほか	売上高	1,389	1,210	<b>1,315</b>	△74 105
	営業利益	△72	△27	<b>△43</b>	29 △16
	営業利益率	△5.2%	△2.2%	<b>△3.3%</b>	2.0% △1.0%
合計	売上高	8,016	8,000	<b>8,000</b>	△16 -
	営業利益	521	470	<b>470</b>	△51 -
	営業利益率	6.5%	5.9%	<b>5.9%</b>	△0.6% -

## △対前期実績

## ●日本

HDD関連部品や半導体プロセス部品など非自動車分野の数量増はあるものの、自動車関連事業の数量減や人件費を含む将来投資の増加等により減益の見込み。

## ●アジア

增收幅の約7割は円安による換算差。中国における日系車の需要減や金属基板の数量減がある一方で、HDD関連部品は上期に引き続き好調に推移。加えてインド拠点の連結子会社化もあり增收増益の見込み。

## ●米欧ほか

主に円高による換算影響により売上金額は減少。当期は追加関税政策の影響も受けたが、北中米を中心とした懸架ばね事業の収支改善が寄与し前年比で赤字幅縮小の見通し。

## △対5月時点予想

## ●日本

自動車関連事業の数量減に加え半導体関連の減速により減収が見込まれるが、諸費用上昇分の回収や棚卸資産に係る連結調整益、更に為替による押上げも寄与し増益の見通し。

## ●アジア

タイ自動車市場の需要低迷や金属基板の数量減はあるものの、HDD関連部品の好調により増益の見通し。

## ●米欧ほか

增收幅のうち約4割は追加関税回収、約1割は円安による換算影響。利益面では懸架ばね事業は概ね期初予想並みだが、シートにおける一過性の費用増が影響し米欧ほか全体では赤字幅が拡大。

# 事業セグメント分析：懸架ばね

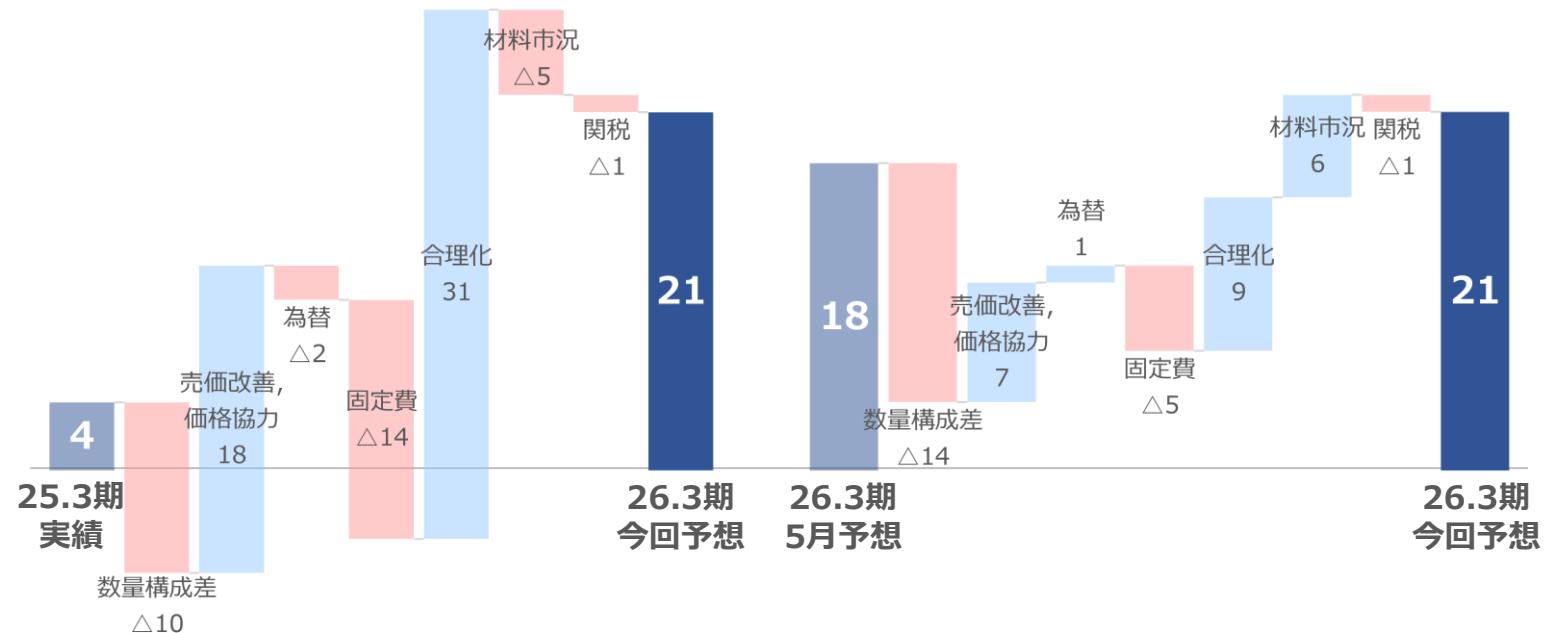
(単位：億円)

	25.3期 実績	26.3期 5月時点予想	26.3期 今回予想	対前期 増減	対5月予想 増減
売上高	1,691	1,575	1,634	△57	59
営業利益	4	18	21	16	2
営業利益率	0.3%	1.1%	1.3%	1.0%	0.1%

## 営業利益の変動要因分析

(対前期増減)

(対5月予想増減)



### △対前期実績

全体としては数量減の傾向だが、タイにおける一部車種の数量増や、前年度に生じたメキシコ新規品立上に伴う費用増の収束、更に価格協力の抑制と合理化努力も寄与し、減収増益となる見通し。

### △対5月時点予想

增收幅の約半分は換算差および米国追加関税の回収による売上増。

輸出の減少等による数量の落ち込みはあるものの、日本およびタイにおける価格協力抑制や諸費用回収が寄与し、增收増益となる見通し。

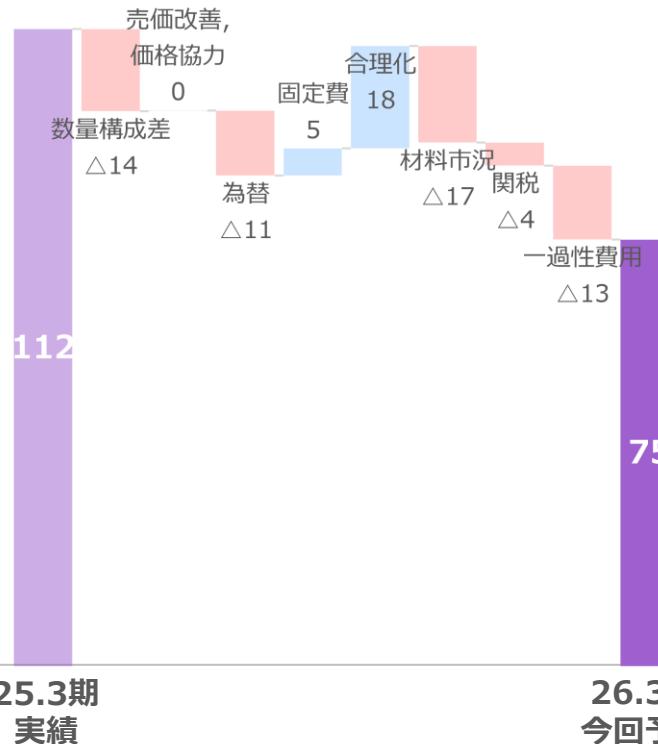
# 事業セグメント分析：シート

(単位：億円)

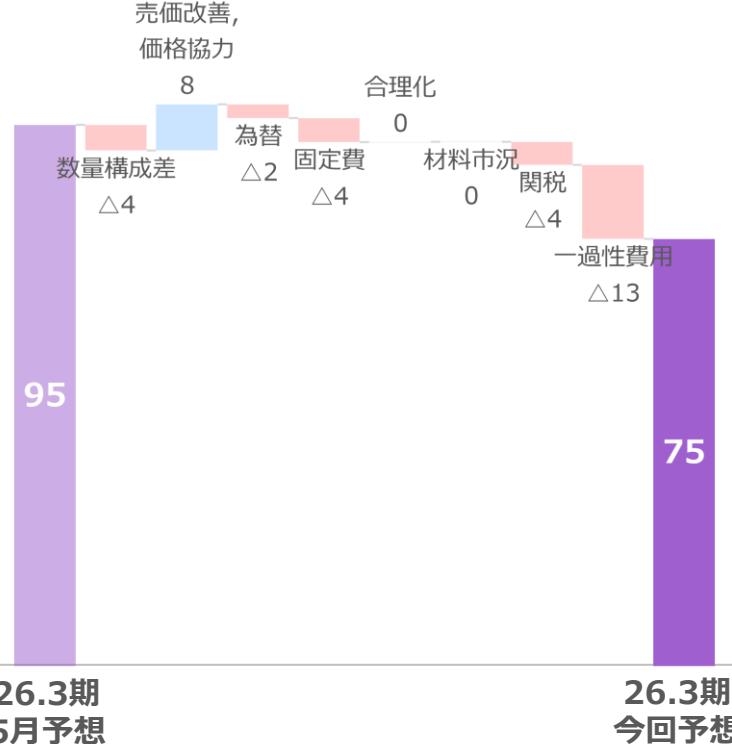
	25.3期 実績	26.3期		対前期 増減	対5月予想 増減
		5月時点予想	今回予想		
売上高	3,039	2,935	2,884	△155	△51
営業利益	112	95	75	△37	△20
営業利益率	3.7%	3.2%	2.6%	△1.1%	△0.6%

## 営業利益の変動要因分析

### (対前期増減)



### (対5月予想増減)



### ▽対前期実績

積極的な合理化を進めるものの、一部の国内客先向け数量減や市況変動影響、更に米国拠点における一過性の費用増等が重なり、減収減益となる見通し。

### ▽対5月時点予想

価格協力抑制や諸費用回収は織り込むものの、日本およびタイにおける想定以上の台数減や、米国拠点の一過性の費用増が影響し、減収減益となる見込み。

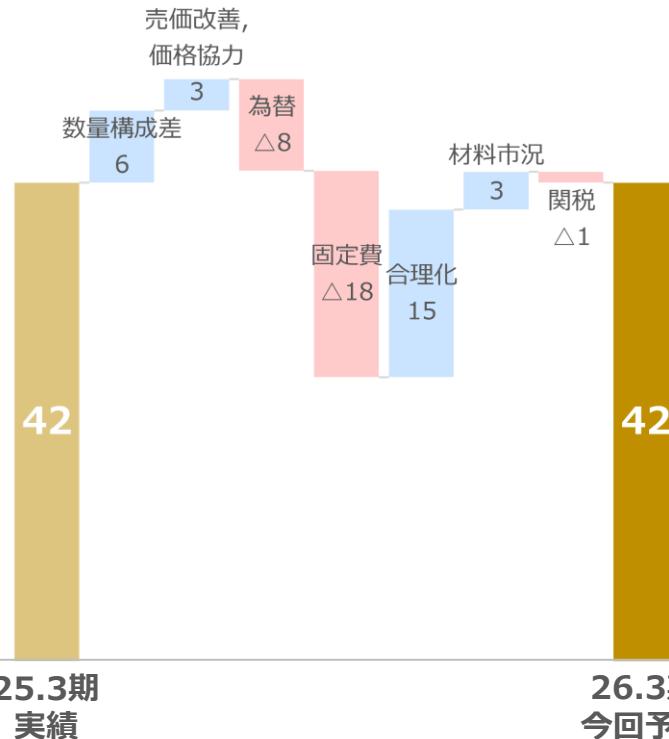
# 事業セグメント分析：精密部品

(単位：億円)

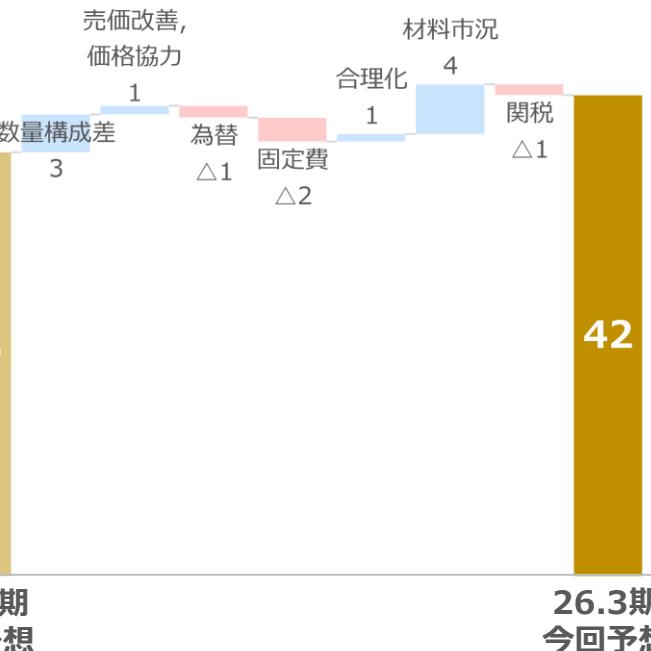
	25.3期 実績	26.3期 5月時点予想	26.3期 今回予想	対前期 増減	対5月予想 増減
売上高	1,019	1,040	1,043	23	2
営業利益	42	37	42	0	5
営業利益率	4.2%	3.6%	4.0%	△0.2%	0.5%

## 営業利益の変動要因分析

### (対前期増減)



### (対5月予想増減)



### ▽対前期実績

タイのHDD用機構部品の増加やインド拠点の連結子会社化などはあったものの人件費を含めた将来投資等による固定費増や為替影響等により、営業利益は前年並みに留まる見通し。

### ▽対5月時点予想

自動車関連分野の数量は概ね期初予想並みに推移。加えて、HDD用機構部品の数量増や材料市況変動による押し上げが寄与し、增收増益となる見込み。

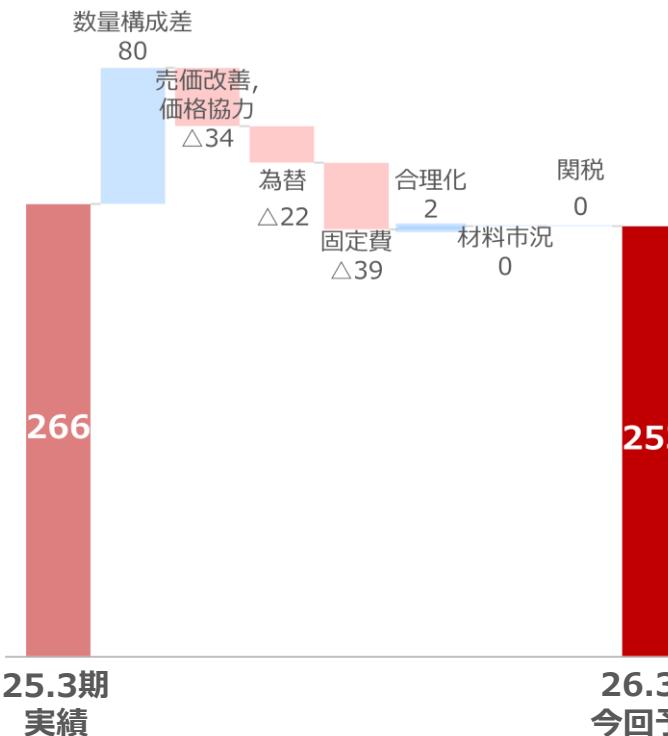
# 事業セグメント分析：DDS

(単位：億円)

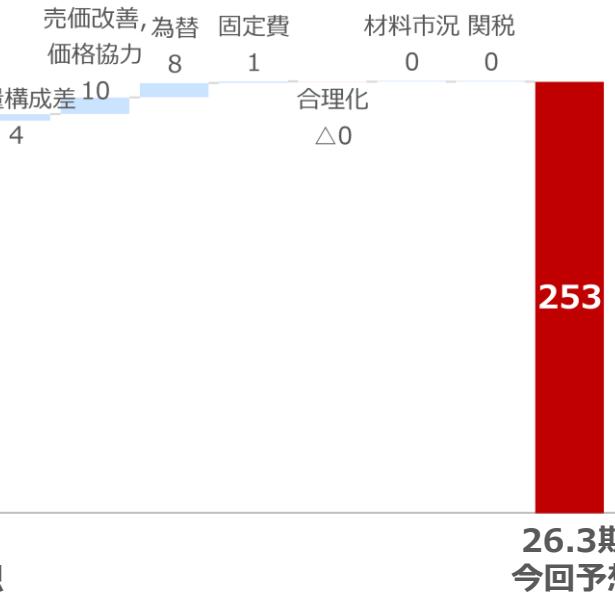
	25.3期 実績	26.3期 5月時点予想	26.3期 今回予想	対前期 増減	対5月予想 増減
売上高	1,115	1,200	1,233	117	33
営業利益	266	230	253	△13	23
営業利益率	23.9%	19.2%	20.5%	△3.4%	1.4%

## 営業利益の変動要因分析

### (対前期増減)



### (対5月予想増減)



### ▽対前期実績

HDD用サスペンションの売上数量は引き続き好調に推移する見通しだが、為替による利益の押し下げや、人件費を含めた将来投資による固定費増等が重なり、增收減益となる見込み。

### ▽対5月時点予想

HDD用サスペンションの需要は上期に引き続き堅調に推移する見通し。

数量増に加え、売価下落の抑制や為替による利益押し上げも寄与し、增收増益となる見込み。

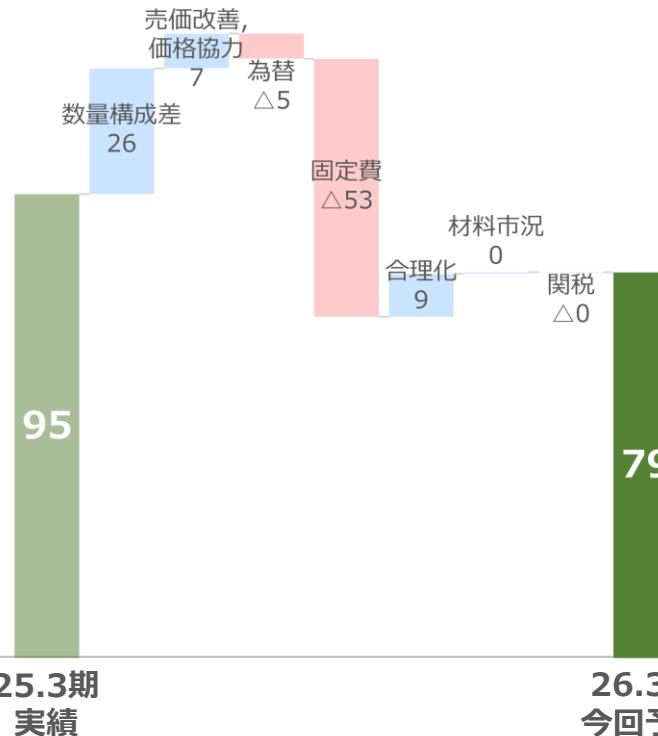
# 事業セグメント分析：産業機器ほか

(単位：億円)

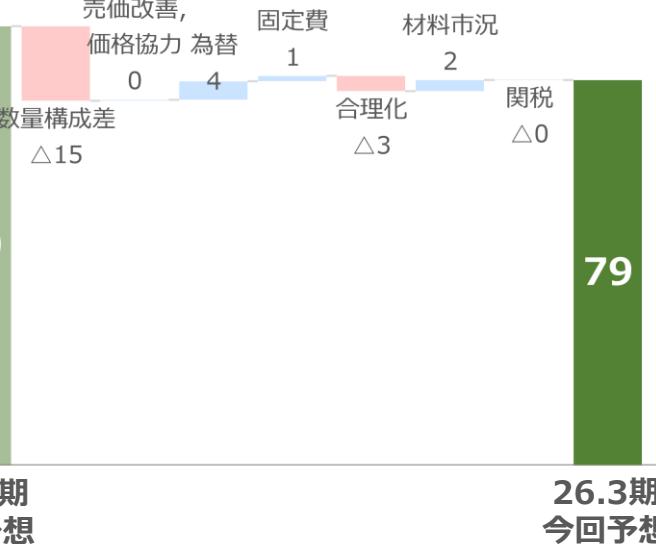
	25.3期 実績	26.3期 5月時点予想	26.3期 今回予想	対前期 増減	対5月予想 増減
売上高	1,151	1,250	<b>1,206</b>	54	△44
営業利益	95	90	<b>79</b>	△16	△11
営業利益率	8.3%	7.2%	<b>6.6%</b>	△1.7%	△0.6%

## 営業利益の変動要因分析

### (対前期増減)



### (対5月予想増減)



### ▽対前期実績

半導体プロセス部品は増加傾向ではあるものの、生産体制拡大や成長事業への先行投資による固定費負担の増加、円高による利益の押し下げ等が影響し、增收減益となる見込み。

### ▽対5月時点予想

NAND需要の減速により 半導体プロセス部品の数量は計画を下回る見通し。

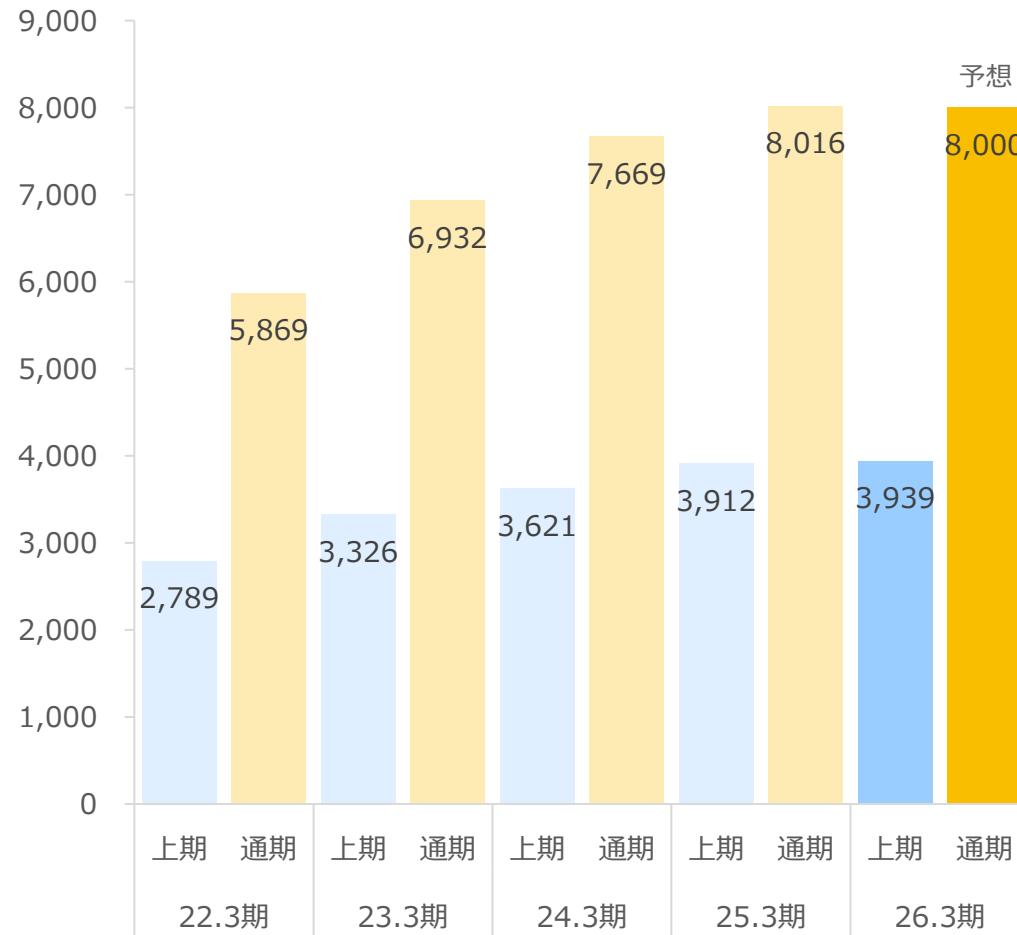
加えてゴルフシャフト・マリンプロダクトの需要回復遅れも影響し、減収減益となる見込み。

# 業績推移

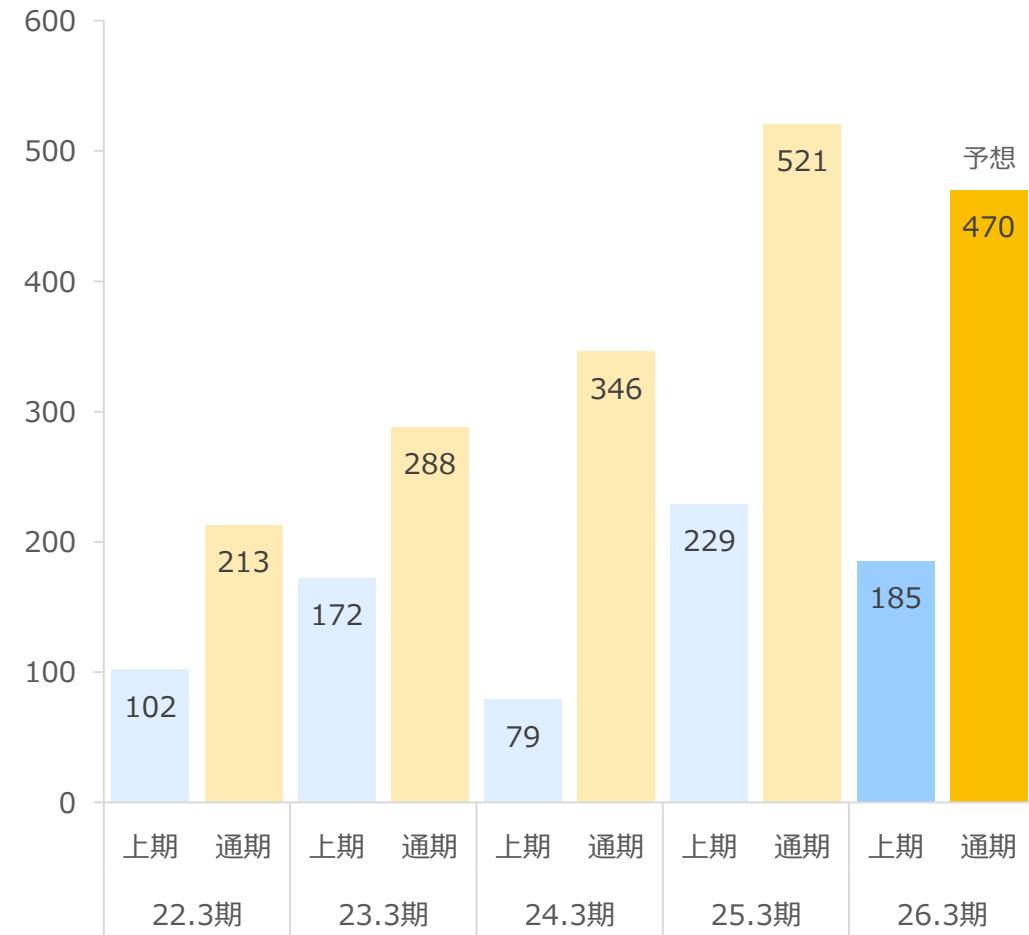
(単位：億円)

NHKニッパツ  
NHK SPRING CO.,LTD.

## 売上高



## 営業利益

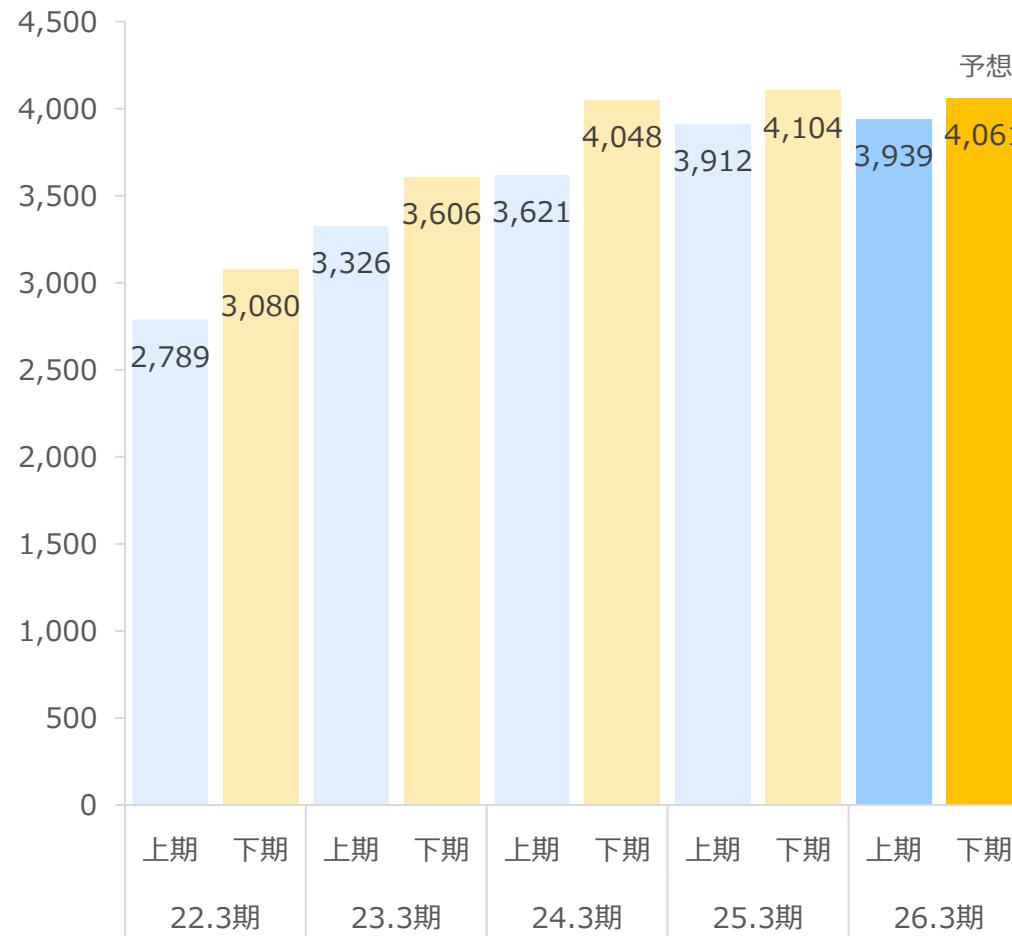


# 業績推移（半期ベース）

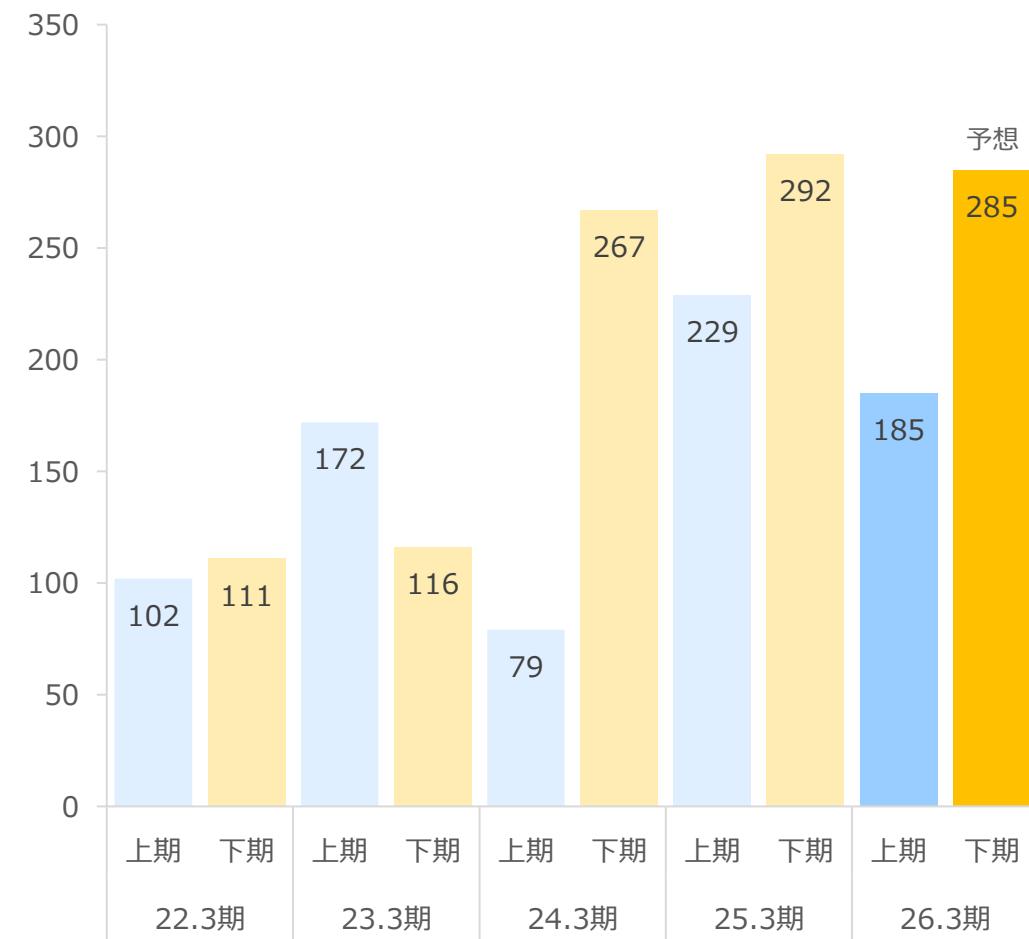
(単位：億円)

NHKニッパツ  
NHK SPRING CO.,LTD.

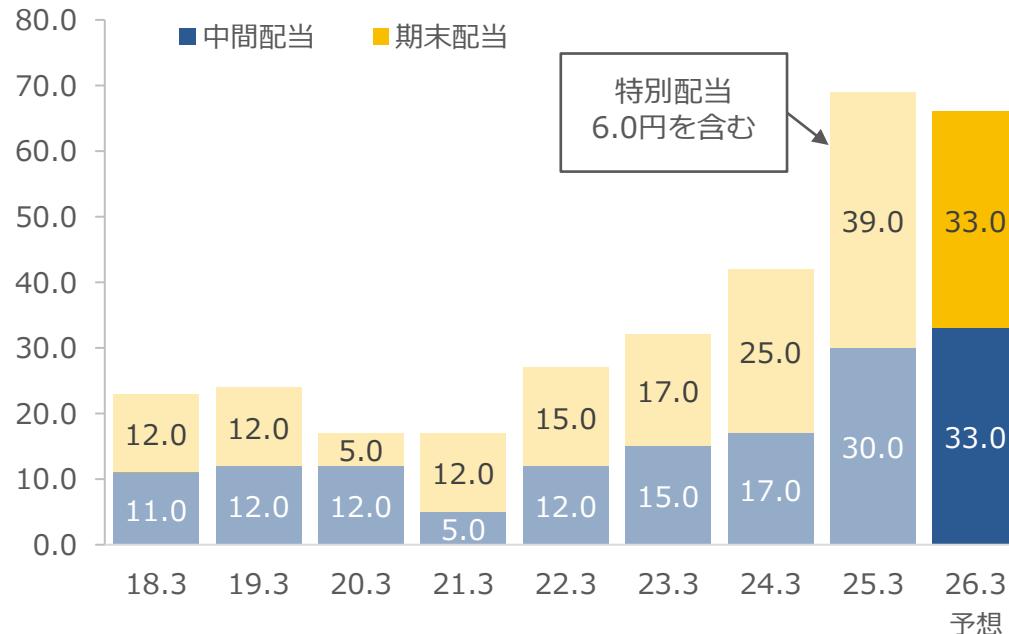
## 売上高



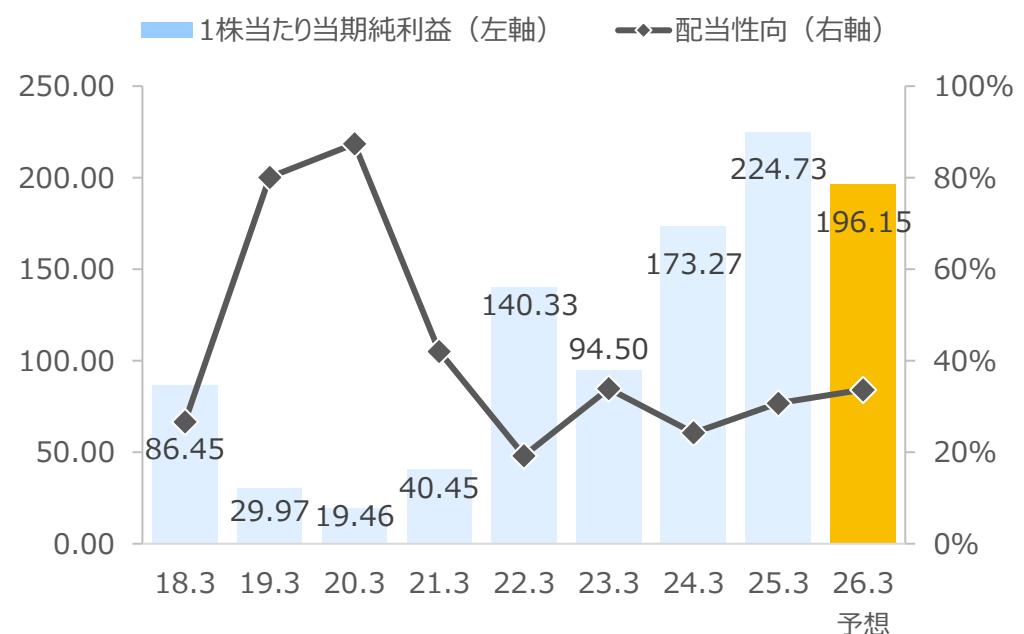
## 営業利益



## 1株当たり配当額



## 1株当たり当期純利益



		第2四半期末	期末	合計	配当性向
<b>25.3期 実績</b>		30.0円	39.0円	<b>69.0円</b>	30.7%
<b>26.3期 予想</b>		33.0円	33.0円	<b>66.0円</b>	33.6%

# 経営指標

NHKニッパツ  
NHK SPRING CO.,LTD.

## 主要経営指標の推移

	22.3期	23.3期	24.3期	25.3期	26.3期 (予想)	26中計目標
収益性	売上高	5,869 億円	6,932 億円	7,669 億円	8,016 億円	<b>8,000 億円</b>
	営業利益 (率)	213 億円 (3.6 %)	288 億円 (4.2 %)	346 億円 (4.5 %)	521 億円 (6.5 %)	<b>470 億円 (5.9 %)</b>
	経常利益 (率)	306 億円 (5.2 %)	373 億円 (5.4 %)	478 億円 (6.2 %)	579 億円 (7.2 %)	<b>530 億円 (6.6 %)</b>
	当期純利益 (率)	319 億円 (5.5 %)	215 億円 (3.1 %)	391 億円 (5.1 %)	481 億円 (6.0 %)	<b>400 億円 (5.0 %)</b>
投資効率	R O E	10.5 %	6.4 %	10.4 %	11.9 %	<b>9.6 %</b>
	R O I C	4.4 %	5.5 %	6.1 %	8.3 %	<b>7.1 %</b>
健全性	自己資本比率	54.9 %	57.6 %	58.7 %	58.5 %	<b>59.3 %</b>

# 足元の経営戦略トピックス

## ～DDS事業について～

代表取締役社長  
COO

上村 和久

## 世界のデータ創出量



出典： 経済産業省資料 「次世代インフラの構築」

## データ創出量の拡大

AI技術の普及

世界のデータ創出量の増加

データセンター需要の増加

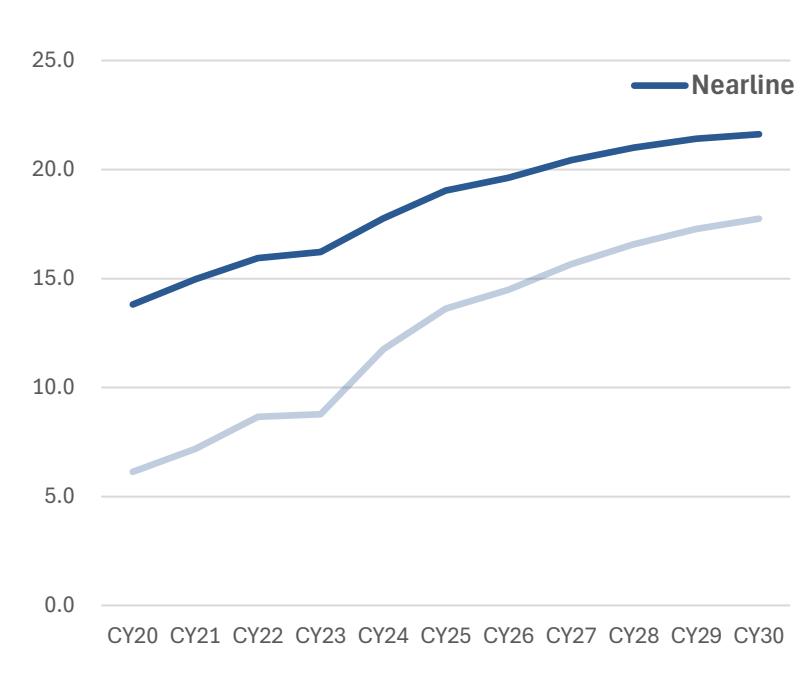
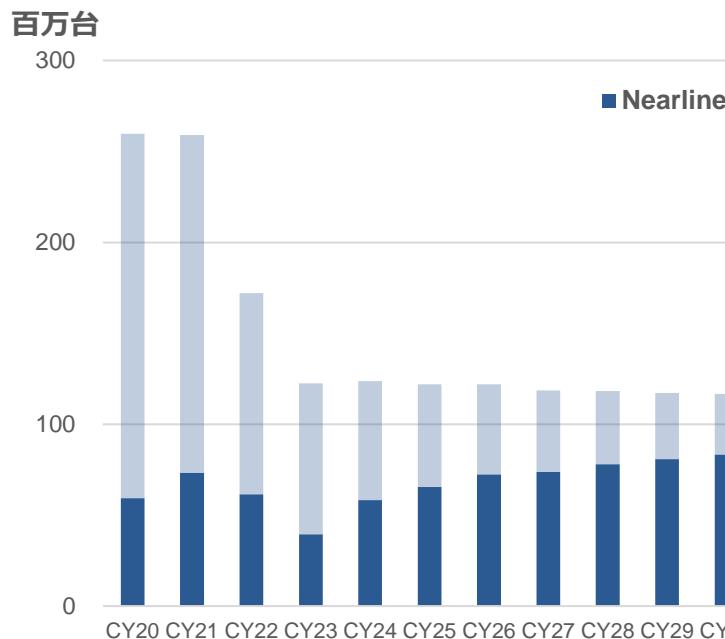
サスペンション需要の増大

ニアラインHDDの増加

ディスクの多枚化



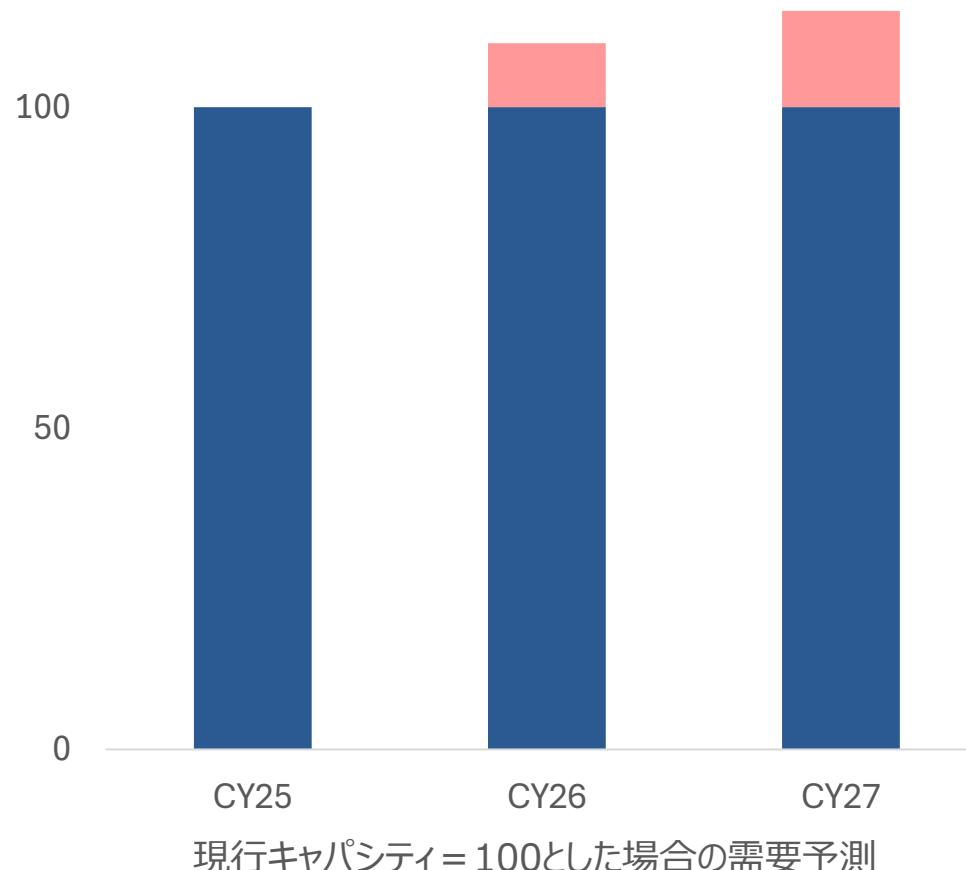
サスペンション需要の拡大



出典：各種資料より弊社作成

HDD出荷台数、サスペンション総量共、2024年以降ニアライン向けが拡大

26年以降  
キャパシティ増強 



## 生産キャパシティの増強

2026年以降、需要が  
生産キャパシティを上回る見込み

拡大する需要に対応するための  
キャパシティ増強の推進

## 最適投資による競争優位性の確立

タイムリーな投資による  
顧客需要の確実な取り込み

競争優位性の確立  
市場シェアの拡大

## 設備投資の内容

### 生産体制の強化

生産キャパシティのタイムリーな増強

モデル切替のためのラインコンバート

### スマートファクトリー化の推進

自動搬送ロボットの導入

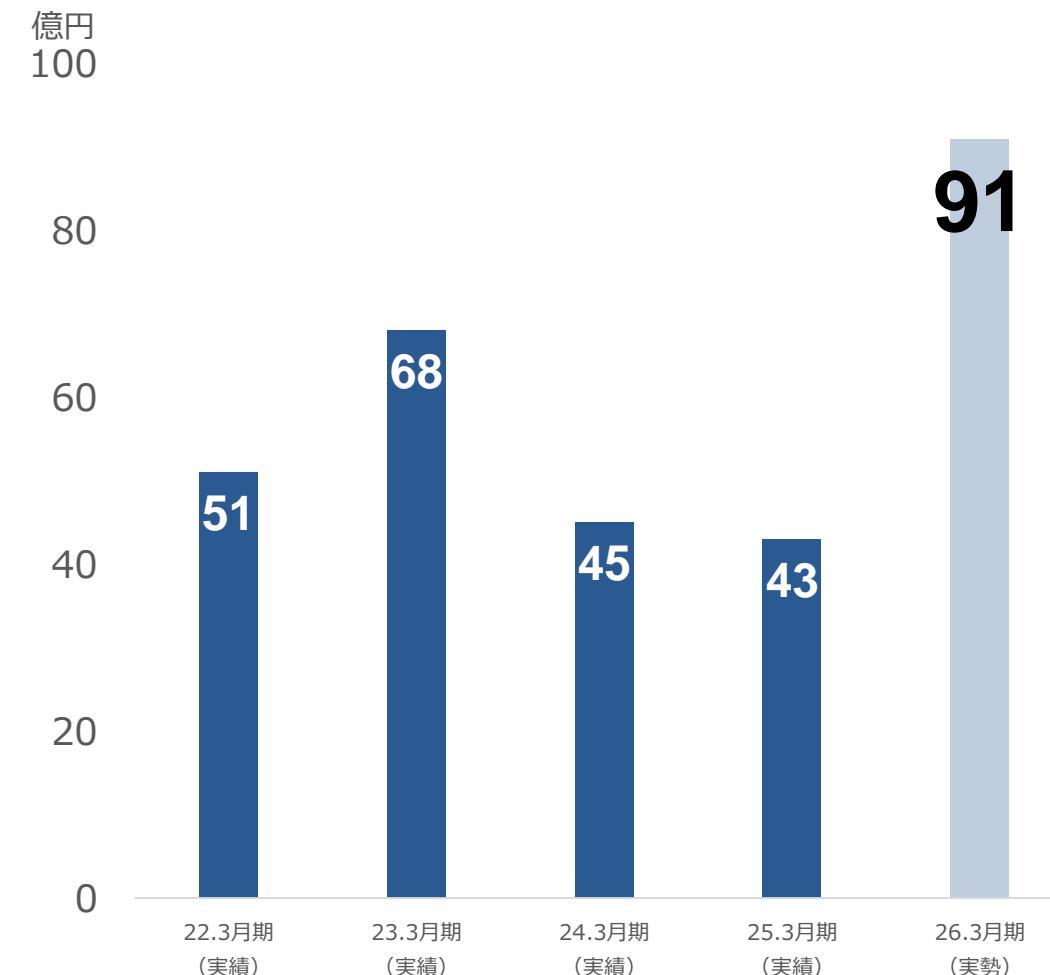
外観検査工程の自動化

### 環境対応 カーボンニュートラル 対応

太陽光発電システムの導入

生産設備のオール電化

## 設備投資金額



## 高容量化技術

HDDのHAMR/MAMR\*への進展

サスペンションの更なる高精度化

## コア技術の進化

製品開発、評価・解析技術の進化

技術の進化に応じた設備開発、  
品質保証体制

## 競争力強化

コア技術による競争優位性の確立

市場シェア拡大、持続的な収益性向上

## サスペンションのコア技術

生産設備  
開発

製品開発

品質

評価技術

グローバル  
生産

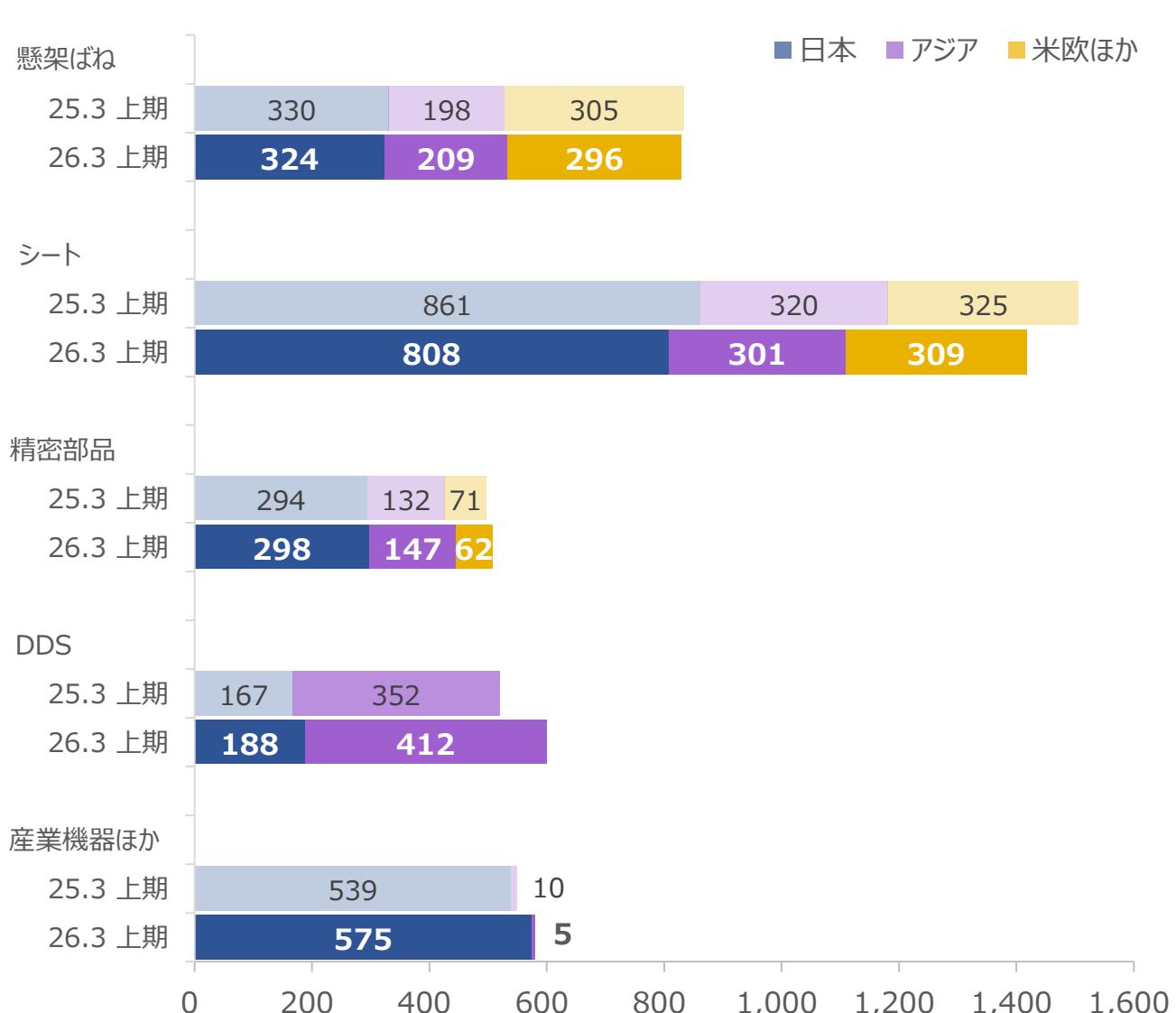
解析技術

\*HAMR = Heat-Assisted Magnetic Recording (熱アシスト磁気記録)

\*MAMR = Microwave-Assisted Magnetic Recording (マイクロ波アシスト磁気記録)

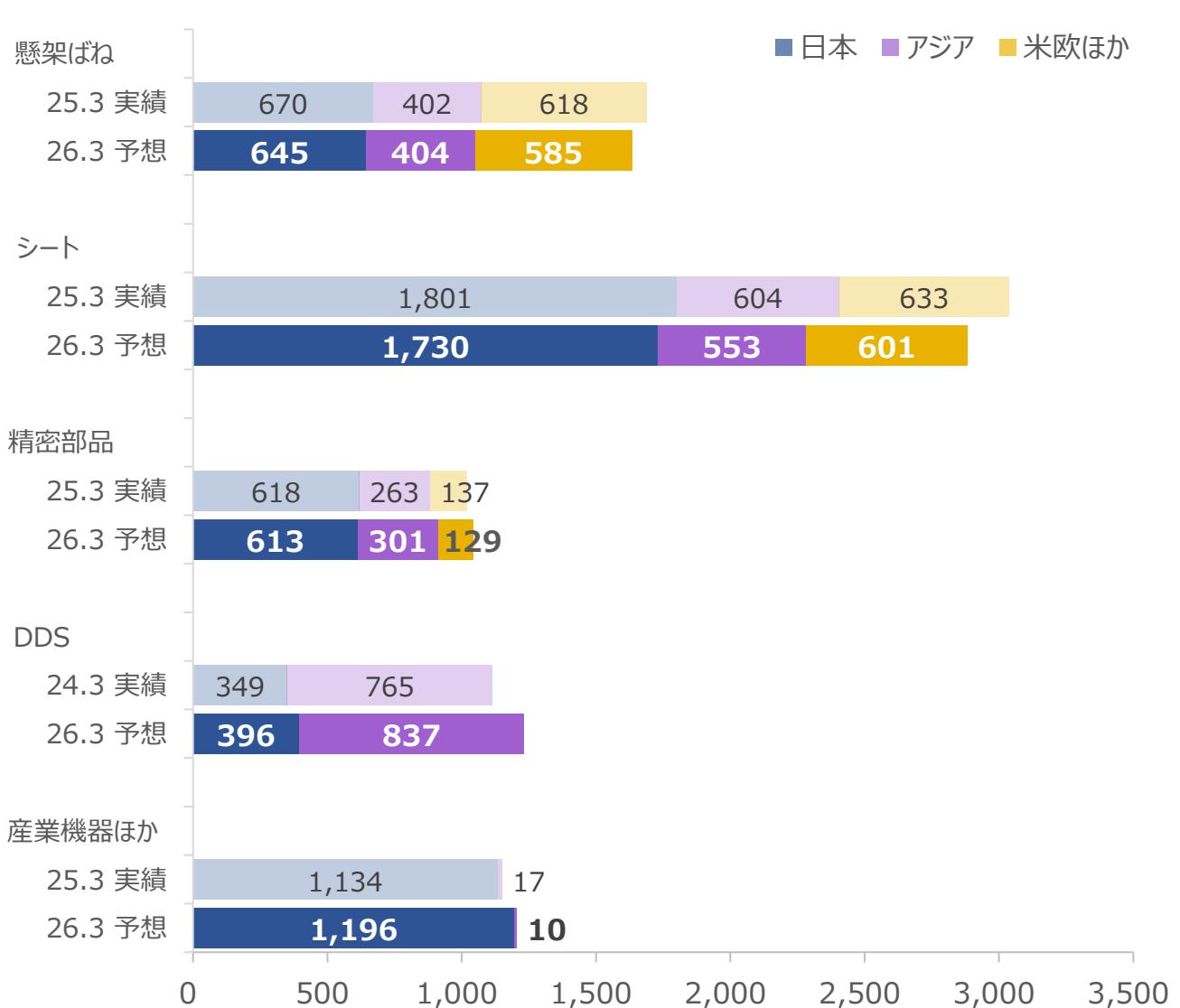
# 補足資料

# 売上高の分解情報（上期）



		日本	アジア	米欧ほか	合計
懸架ばね	25.3 上期	330	198	305	835
	26.3 上期	324	209	296	830
シート	25.3 上期	861	320	325	1,508
	26.3 上期	808	301	309	1,420
精密部品	25.3 上期	294	132	71	498
	26.3 上期	298	147	62	508
DDS	25.3 上期	167	352	-	519
	26.3 上期	188	412	-	600
産業機器ほか	25.3 上期	539	10	-	550
	26.3 上期	575	5	-	580
合計	25.3 上期	2,194	1,014	702	3,912
	26.3 上期	2,194	1,076	668	3,939

# 売上高の分解情報（通期）



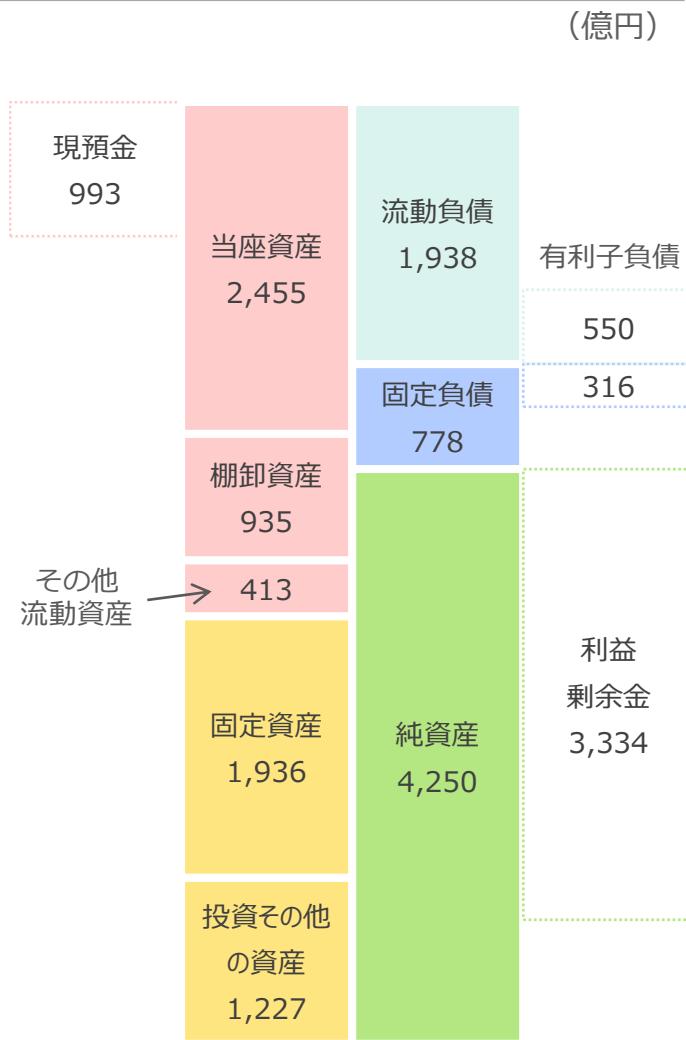
		日本	アジア	米欧ほか	合計
懸架ばね	25.3 実績	670	402	618	1,691
	26.3 予想	645	404	585	1,634
シート	25.3 実績	1,801	604	633	3,039
	26.3 予想	1,730	553	601	2,884
精密部品	25.3 実績	618	263	137	1,019
	26.3 予想	613	301	129	1,043
DDS	25.3 実績	349	765	-	1,115
	26.3 予想	396	837	-	1,233
産業機器ほか	25.3 実績	1,134	17	-	1,151
	26.3 予想	1,196	10	-	1,206
合計	25.3 実績	4,574	2,053	1,389	8,016
	26.3 予想	4,580	2,105	1,315	8,000

# 資産の状況

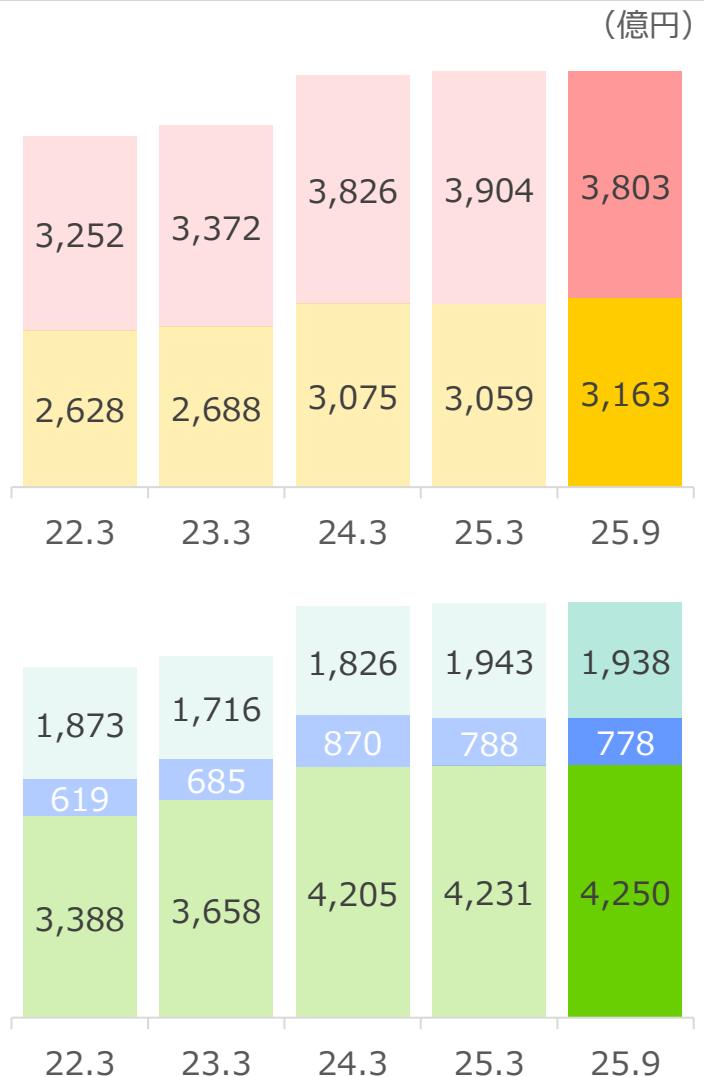
	22.3期 実績	23.3期 実績	24.3期 実績	25.3期 実績	26.3期 上期実績	(億円) 増減額
<b>総資産</b>	5,880	6,060	6,902	6,963	<b>6,967</b>	4
<b>自己資本</b>	3,226	3,492	4,050	4,076	<b>4,096</b>	20
<b>自己資本比率</b>	54.9%	57.6%	58.7%	58.5%	<b>58.8%</b>	0.3%
<b>現預金</b>	921	729	1,032	972	<b>993</b>	21
<b>有利子負債</b>	508	505	474	718	<b>866</b>	148
<b>ネットキャッシュ</b>	413	224	558	254	<b>127</b>	△127

# バランス・シートの状況

26.3期 上期実績



バランス・シート推移



## ▼資産

営業取引の減少により営業債権等が減少した一方、時価評価により投資有価証券が増加したほか、設備投資額等が増加したことにより増加。

## ▼負債

有利子負債が増加した一方、支払サイト短縮に伴う仕入債務の減少等により減少。

## ▼純資産

自己株式の取得や為替が円高に推移したことにより為替換算調整勘定は減少したものの、その他有価証券評価差額金および親会社株主に帰属する中間純利益による利益剰余金が増加したことにより増加。

# 設備投資・減価償却費（事業セグメント別）

(億円)

	24.3期 実績	25.3期 実績	5月時点予想	26.3期 今回予想	5月予想差
<b>設備投資</b>	懸架ばね	58	63	105	<b>107</b>
	シート	49	64	53	<b>64</b>
	精密部品	107	79	110	<b>114</b>
	DDS	45	43	99	<b>91</b>
	産業機器ほか	82	126	123	<b>168</b>
	全社共有	27	25	50	<b>42</b>
	合計	370	402	540	<b>586</b>
	前期比	31.8%	8.8%	34.2%	<b>45.6%</b>
<b>減価償却費</b>	懸架ばね	63	54	57	<b>58</b>
	シート	56	52	47	<b>46</b>
	精密部品	47	52	55	<b>55</b>
	DDS	63	64	68	<b>60</b>
	産業機器ほか	35	41	56	<b>54</b>
	全社共有	19	28	24	<b>25</b>
	合計	286	293	307	<b>298</b>
	前期比	△0.7%	2.3%	4.8%	<b>1.6%</b>

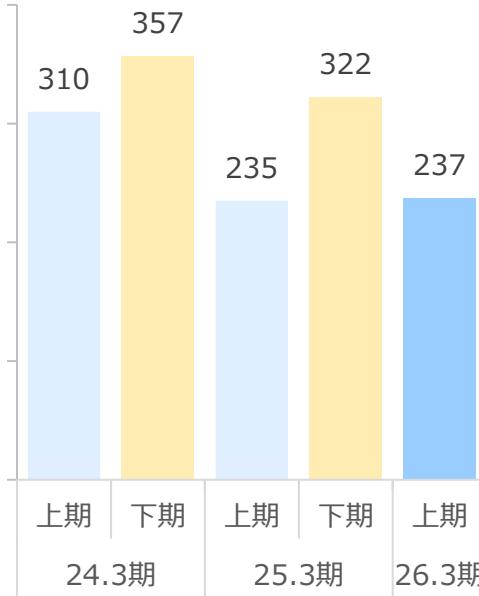
# 設備投資・減価償却費（地域セグメント別）

(億円)

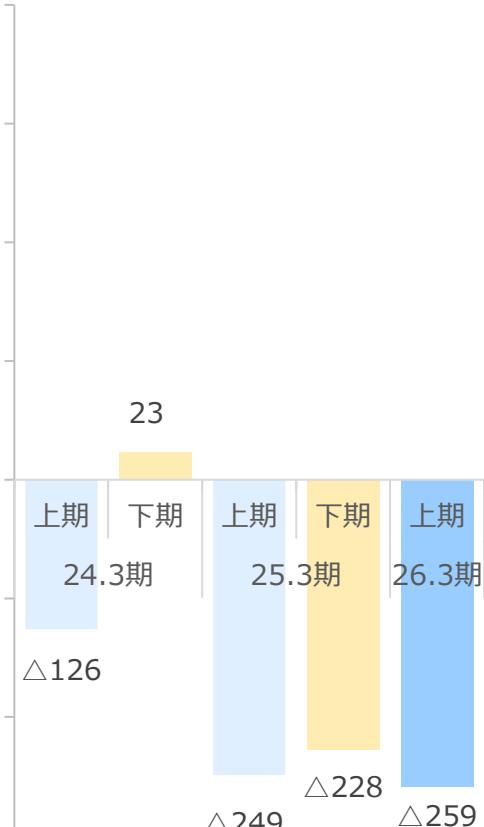
		24.3期 実績	25.3期 実績	5月時点予想	26.3期 今回予想	5月予想差
<b>設備投資</b>	日本	259	242	371	<b>424</b>	53
	アジア	75	88	110	<b>115</b>	5
	米欧ほか	34	71	59	<b>47</b>	△12
	海外計	110	159	169	<b>162</b>	△7
	合計	370	402	540	<b>586</b>	46
<b>減価償却費</b>	日本	146	165	185	<b>174</b>	△11
	アジア	92	86	82	<b>83</b>	1
	米欧ほか	47	40	40	<b>41</b>	1
	海外計	139	127	122	<b>124</b>	2
	合計	286	293	307	<b>298</b>	△9

# キャッシュ・フローの状況（半期ベース）

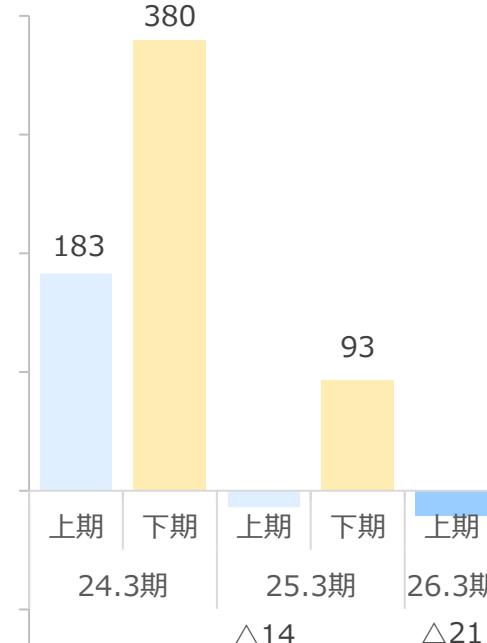
営業CF



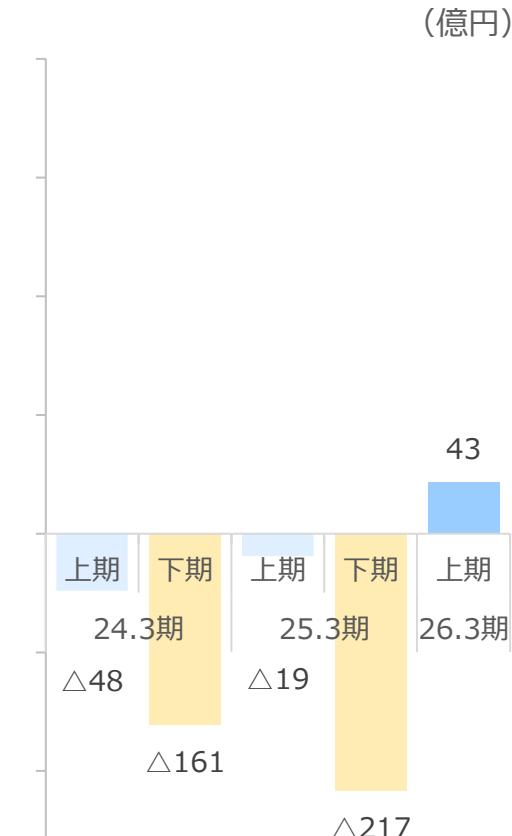
投資CF



フリーCF



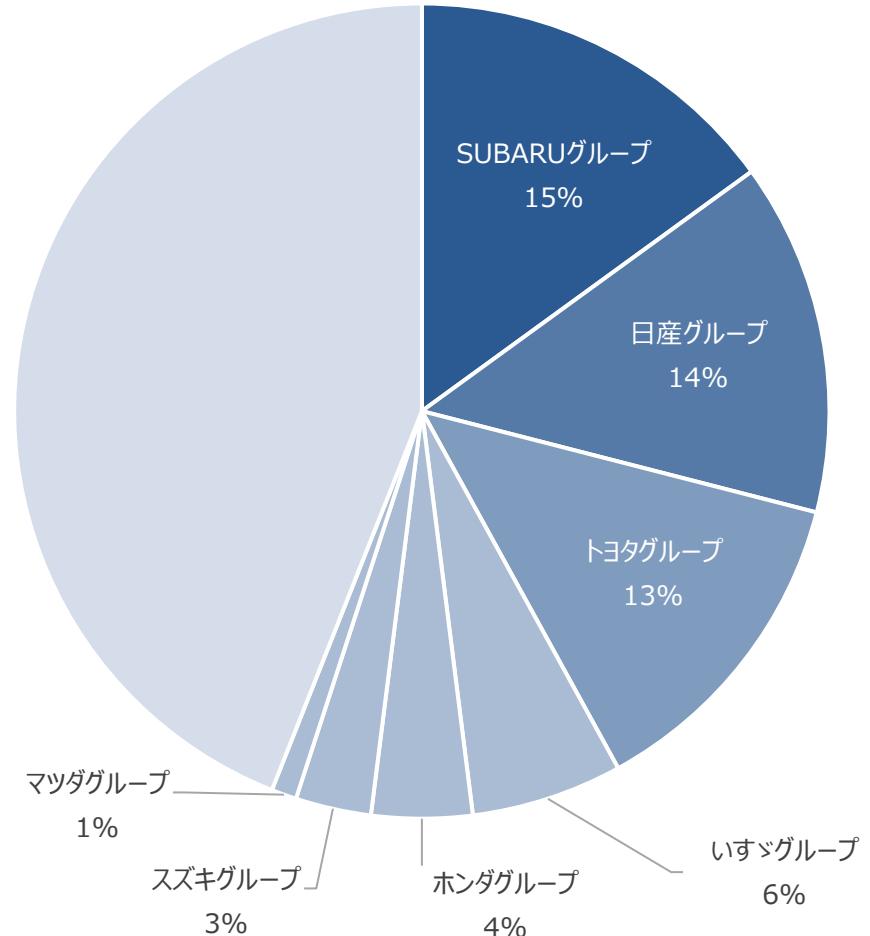
財務CF



# 総売上高に占める主要カーメーカーへの売上比率は？

主要カーメーカー	24.3期 実績	25.3期 実績
SUBARUグループ	18%	<b>15%</b>
日産グループ	16%	<b>14%</b>
トヨタグループ	13%	<b>13%</b>
いすゞグループ	7%	<b>6%</b>
ホンダグループ	4%	<b>4%</b>
スズキグループ	4%	<b>3%</b>
マツダグループ	1%	<b>1%</b>
上位3社	47%	<b>42%</b>

(注) 比率は総売上高に対する割合



# 四半期別売上推移 (モーターコア、半導体プロセス部品、金属基板、レジヤー分野)

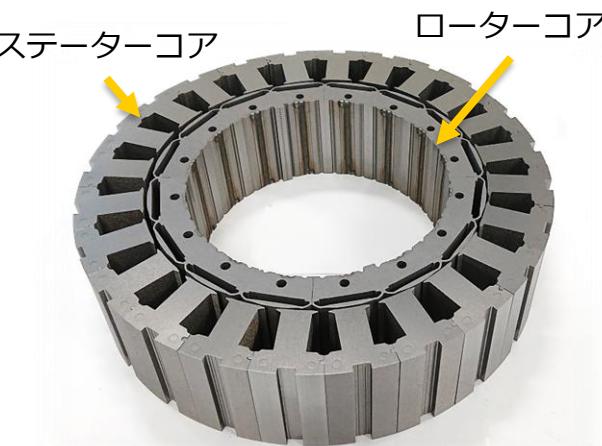
(億円)

		25.3期							26.3期				
		1Q	2Q	上期	3Q	4Q	下期	通期	1Q	2Q	上期	下期	通期
精密部品	モーターコア	29	31	61	31	33	65	127	27	30	58	68	127
産業機器ほか	半導体プロセス部品	37	47	84	55	62	117	202	59	60	119	132	252
	金属基板	19	19	39	18	17	35	75	18	17	36	46	82
	レジヤー分野 (ゴルフプロダクト・マリンプロダクト等)	34	32	66	36	35	71	138	35	34	70	71	141

# 主要海外拠点



## ■モーターコア



当社で手がけるモーターコアは、EV、HV自動車の駆動用、または発電用モーターに使用される積層鉄心です。

0.25～0.35mmの電磁鋼板をプレスで打ち抜いて数百枚積層したもので、カシメや溶接により締結されております。

モーターコアは磁石が挿入されてモーターの回転部となるローターコアと、固定となる巻き線部のステーターコアから構成されます。

バッテリーからの電力がインバーターを介してモーターに供給され、コイルを巻き付けたステーターコアに発生する回転磁界の作用によりマグネットが組み込まれたローターコアが吸引・反発することでローターコアが高速回転します。

薄板の積層鉄心であるモーターコアは磁力線が通りやすく、より強い磁力を発生させる機能を持ちます。

モーターコアは直径200mm前後、高さ150mm前後で、当社で手がける精密プレス加工品としては比較的大きいサイズとなります。必要とされる製品寸法精度がミクロンレベルであり、当社で長年かけて築き上げてきた自動車用部品の精密プレス加工技術や、HDD（ハードディスクドライブ）用部品の精密プレス加工技術を駆使した、大型の超高精度プレス加工品であります。

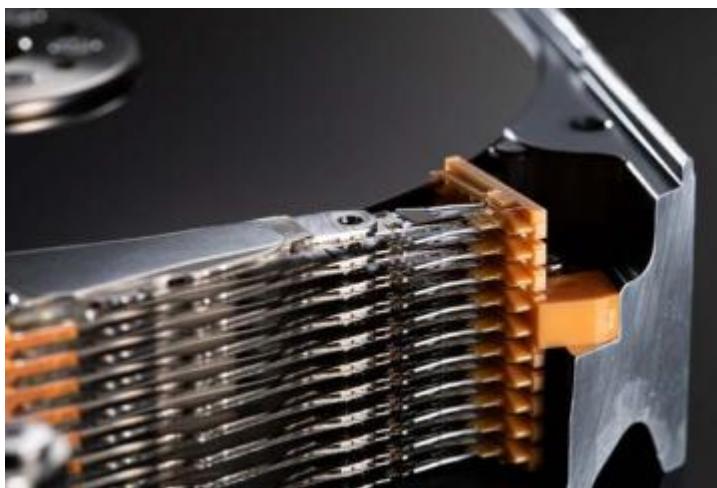
モーターコアの生産において肝となるプレス金型は、設計～製作～メンテナンスまで一貫して自社で行っており、国内だけでなく、グローバル展開しておりますメキシコ、中国の工場でも同じ品質のモーターコアの生産が可能です。

# 製品紹介：HDD用サスペンション (DDSセグメント)

## ■HDDサスペンション



## ■HDDサスペンション搭載箇所



HDD用サスペンションは、HDDの中で、ディスク上のデータを読み書きする微小部品を支える特殊ばね製品です。

近年HDDはパソコン向けよりも、SNSや動画共有サイトなどのデータセンター向けが多くなっています。データセンターではギガサイズのファイルを大量に保存するため、大容量HDDが数十万個単位で並んでいて、そのHDD一つ一つに多くのHDD用サスペンションが搭載されています。左の写真ではHDD 1台に20個、データセンター全体では膨大な数のHDD用サスペンションが使われています。

大容量HDD用サスペンションには、超小型アクチュエータが組み込まれており、データを読み書きする微小部品を微細に動かし、ディスク上のデータをより高密度で読み書きする事が出来ます。

この超小型アクチュエータを、製品中央部に組み込んだものをDSA、先端部に組み込んだものをCLAと呼んでいます。人で例えるならDSAは手首、CLAは指先が動くイメージです。またさらに高性能な製品としてDSAとCLAの両方を組み込んだ、現在主力のTSAを開発しました。繊細かつダイナミックな動きが可能で、データセンターで使用するHDDのさらなる大容量化に貢献します。

当社はCLAやTSAを世界に先駆け量産化、グローバルでトップシェアを有しております。

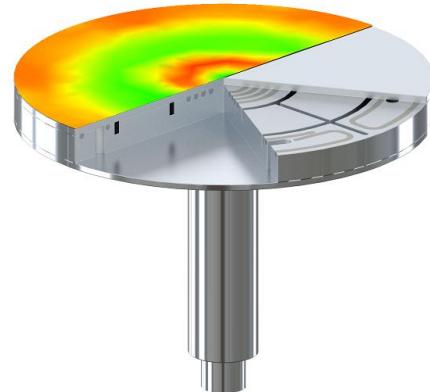
\*DSA = Dual Stage Actuatorの略

\*CLA = Co-Located Actuatorの略

\*TSA = Triple Stage Actuatorの略

# 半導体関連製品

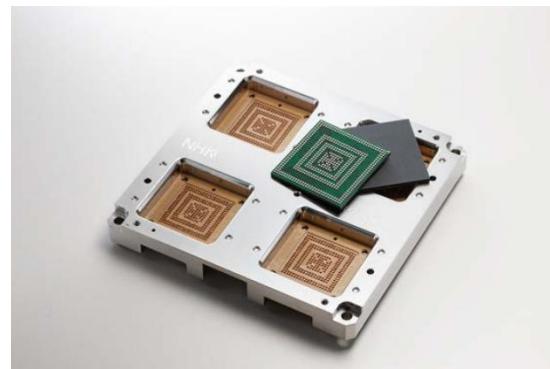
■成膜装置用マルチゾーン制御ステージヒータ



前工程

半導体  
製造工程

■テストソケット



■コンタクトプローブ（マイクロコンタクタ®）



■エッティング装置用溶射付冷却板



■プローブカード



# 製品紹介：半導体テスト器具 (DDSセグメント)

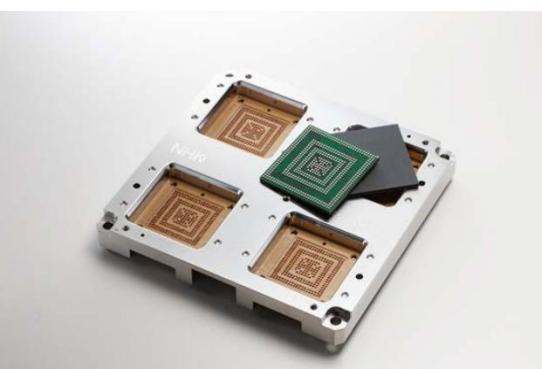
## ■コンタクトプローブ (マイクロコンタクタ®)



## ■プローブカード



## ■テストソケット



半導体テストとは、半導体製品に電気を流して正常に動作するかを検査することです。半導体テスト器具は、半導体テストにおいて半導体とテスト装置をつなぐ役割を果たします。当社は、前工程（半導体ウェハー工程）の検査で使用するプローブカードと後工程（パッケージ工程※）の検査で使用するテストソケット、およびそれらに組み込むばね製品、コンタクトプローブ（マイクロコンタクタ®）を世界中の半導体メーカーやその関連企業に提供しています。

### マイクロコンタクタ

半導体テストで用いられる微細ばねを使用した検査端子です。テスト装置から出力された電気信号は、マイクロコンタクタを介して半導体へと送られます。半導体の端子に合わせて、さまざまな先端形状の加工が必要であり、当社は設計から加工まで、自社工場内で一貫して行うことができます。また顧客の要望に応じた特殊形状の提案も可能です。

### プローブカード

前工程で用いられる器具です。微細穴を開けた円盤状の板にマイクロコンタクタが数十本から数千本、多いものでは数万本組み込まれています。検査対象であるウェハー上には半導体の微細な端子が無数にあり、その一つ一つにマイクロコンタクタを正確に接触させて個々の半導体の電気的特性（良否）を検査します。この正確で均一な接触のため、導通性能や寸法精度の高いマイクロコンタクタを使用することが重要です。

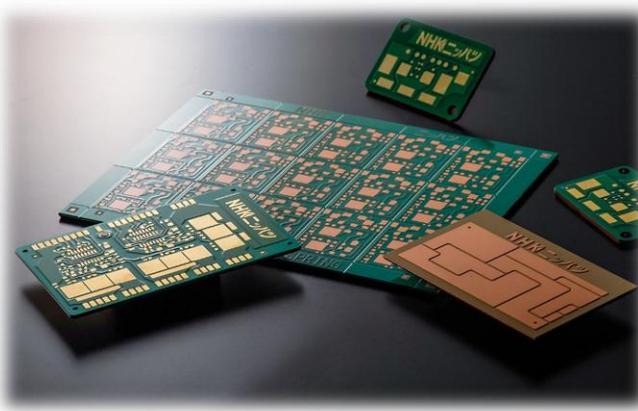
### テストソケット

後工程で用いられる器具です。ソケットに挿入された個々の半導体パッケージは、マイクロコンタクタを介してテスト装置と接続され、電気特性や信頼性の試験が行われます。

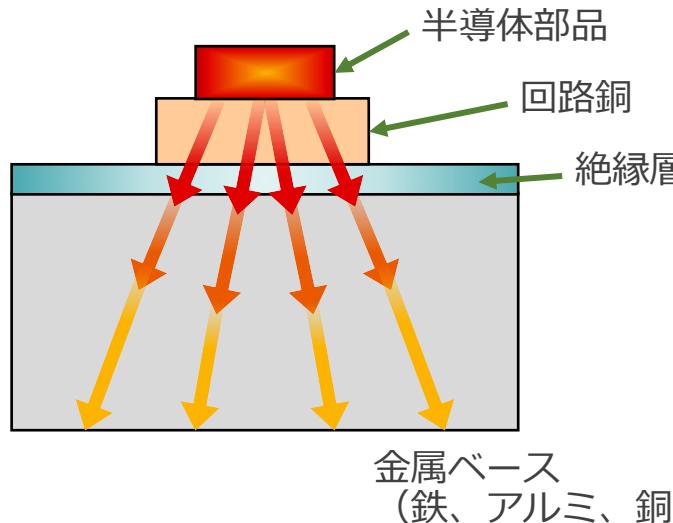
※パッケージ工程（半導体ウェハーから切り出されたICを回路の保護や外部の周辺回路と接続をしやすくするため、プラスチックやセラミックで封入する工程）

# 製品紹介：金属基板～Integrated Metal Substrate～

(産業機器ほかセグメント)



## ■ IMSの断面構造図



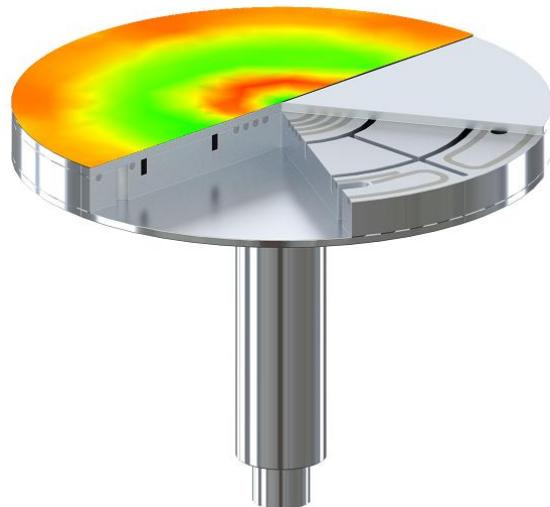
金属基板（以下IMS）は、ベースにアルミや銅などの金属板の上に絶縁層を介して回路を形成したもので、放熱性が優れているという特徴があります。その放熱性を活かして、車載用、産業用、民生用の分野で、IMS上に実装される半導体部品などが発生させる熱を効率よく逃がすという働きで使われております。

自動車分野では、電気自動車やハイブリッド車に搭載されるDC-DCコンバータや充電器モジュールなどへの採用が増えており、将来的には駆動用のインバータ回路への採用を目指しております。産業用途では、汎用インバータやエアコンのインバータ回路の他にも、再生可能エネルギーのパワーコンディショナー内部のパワーモジュールとして当社IMSが多く使用しております。

当社のIMSの特徴は、高放熱・高信頼な絶縁層の開発からIMS製造までの一貫生産を行うことを強みとしております。

当社では、1980年代よりIMS開発を開始し、現在に至るまで次々と高放熱絶縁材を市場に送り出し業界をリードしております。

## ■成膜装置用マルチゾーン制御ステージヒータ



## ■エッティング装置用溶射付冷却板



半導体はシリコンの基板上に導線および絶縁物が微細かつ複雑なパターンで描かれ、回路が形成されています。ニッパツの半導体プロセス部品は半導体製造の主要工程である“成膜”および“エッティング”的工程で用いられています。

ニッパツのステージヒータはCVD、ALD\*などの成膜工程で広く採用されています。主にアルミ合金、ステンレスなどの金属製で、長年培ってきた高度な接合技術により、複雑な内部構造の実現が可能です。

\*CVD ; Chemical Vapor Deposition（化学気相成長）の略

\*ALD ; Atomic Layer Deposition（原子層堆積）の略

ヒータエレメントの設計技術、シミュレーションのための解析技術を駆使し、複数のヒータエレメントや冷媒用チャンネル、断熱空間を配置し、均一な温度分布のみならず、部分的に数十度の範囲で差を生み出す、積極的な温度分布制御を可能にしています。

一方エッティング装置向けにおいては、冷却板と呼ばれる、プロセス中のシリコンウエハが載荷される、重要なステージ部品を製造しています。多くはアルミ合金で造られており、ヒータ同様高度接合技術を核に、材料調達から精密加工、セラミクス溶射施工までの一貫生産を強みとしています。

近年では、チャンバ下部でウエハを支持するヒータ、冷却板に加え、チャンバ上部に設置され、プロセスに必要なガスを供給するための部品であるシャワーヘッドの開発にも注力しております。

# NHKニッパツ

- 本資料に記載している日本発条(株)の予想、計画は、将来の実績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、経済情勢、市場動向、為替の動向等、重要な要素の変動により、見通しとは異なる結果となり得ることもご承知下さい。
- 本資料に掲載されている事項は情報提供を目的とするものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。
- この資料の著作権は日本発条(株)に帰属しております。
- 無断転載・複製することを禁じます。